

2025年12月期

決算説明資料



株式会社 RS Technologies

2026年2月13日

プライム市場 3445

目次

01	決算概要	P.03
02	中期経営計画 (26年～28年)	P.09
03	会社概要	P.21
04	Appendix	P.49



2025年12月期 決算概要

01

売上高

76,707 百万円
前同比 +29.6%

営業利益

14,281 百万円
前同比 +8.9%

経常利益

16,635 百万円
前同比 +6.2%

親会社株主に帰属する当期純利益

9,297 百万円
前同比 △1.6%

- 2025年12月期の売上高、営業利益および経常利益は、過去最高を更新
- 親会社に帰属する当期純利益は、9,297百万円となった
(前期当期共にRSPDH取得による負ののれんを計上しており、当該負ののれんを除去した場合は前期比984百万円増加)

【セグメント別】

ウェーハ再生事業

- 国内外の半導体工場からの再生ウェーハの需要状況は良好で、三本木、台南工場はフル稼働で生産
 - 2026年は、三本木第7工場の再稼働計画(※)を前倒し、さらに高まる需要に対応予定
- (※2024年9月27日開示「ウェーハ再生事業における設備投資計画に関するお知らせ」から前倒し)

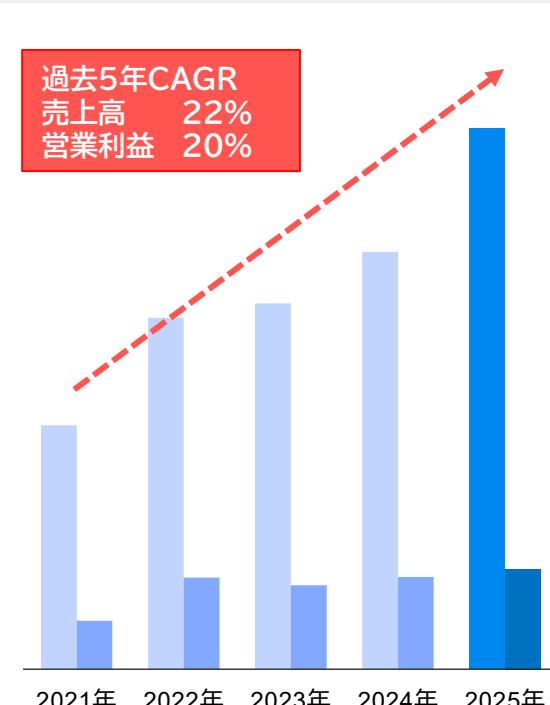
プライムウェーハ事業

- パワー半導体需要回復により、当社主力製品であるパワー半導体向け8インチウェーハの出荷枚数が増加
- シリコン部材は、新規顧客開拓を実施し、出荷数量が増加
- 2026年は、+5万枚の8インチウェーハの増産設備投資を行い、中国市場のシェアアップを図る

半導体関連装置・部材等事業

- RSPDHにて光ピックアップモジュールを前倒し生産したことが、增收増益に寄与
- エネルギー事業では、LEシステムに加え、6月に中国子会社RS能源を新設し、事業推進体制を強化
- VRFB用電解液をスペインの蓄電所向けに商業用として初出荷

過去5年CAGR
売上高 22%
営業利益 20%



2025年12月期 決算概況



(百万円)	2024年12月期	2025年12月期	前同比	差額
売 上 高	59,200	76,707	29.6%	17,507
売 上 原 價	39,820	53,122	33.4%	13,302
売 上 総 利 益	19,380	23,585	21.7%	4,205
販 売 管 理 費	6,271	9,303	48.3%	3,032
営 業 利 益	13,108	14,281	8.9%	1,173
営 業 外 収 益	3,392	3,766	① 11.0%	374
営 業 外 費 用	833	1,412	② 69.5%	579
経 常 利 益	15,668	16,635	6.2%	967
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益	9,446	9,297	△1.6%	△149
一株当たり当期純利益(円)	358.21	351.40	△1.9%	△6.8

主な要因説明

①

補助金収入(政府からGritekへ)
1,120百万円→2,108百万円

為替差益

726百万円→0円

②

為替差損

0円→88百万円

・前四半期比では、円安基調の影響を受け改善傾向
為替差損第3四半期 462百万円→88百万円

持分法による投資損失(中国12インチ事業SGRS)

685百万円→1,082百万円

・事業成長を見込んだ投資フェーズであることから
投資損失が増加するものの、事業は着実に進捗

・2025年1月に設備投資を使途とした増資を行ったこと
により当社持分比率が上昇

2025年12月期 セグメント動向



- ・ウェーハ再生事業は、増産設備投資により生産数量が増加し、前年同期比增收増益で推移
- ・プライムウェーハ事業は、8インチウェーハの平均単価は低下したものの、市況回復基調により生産数量が増加し增收
- ・半導体関連装置・部材等事業は、今期より新規事業RSPDHの売上高が加わったことにより前年同期比增收増益

(百万円)

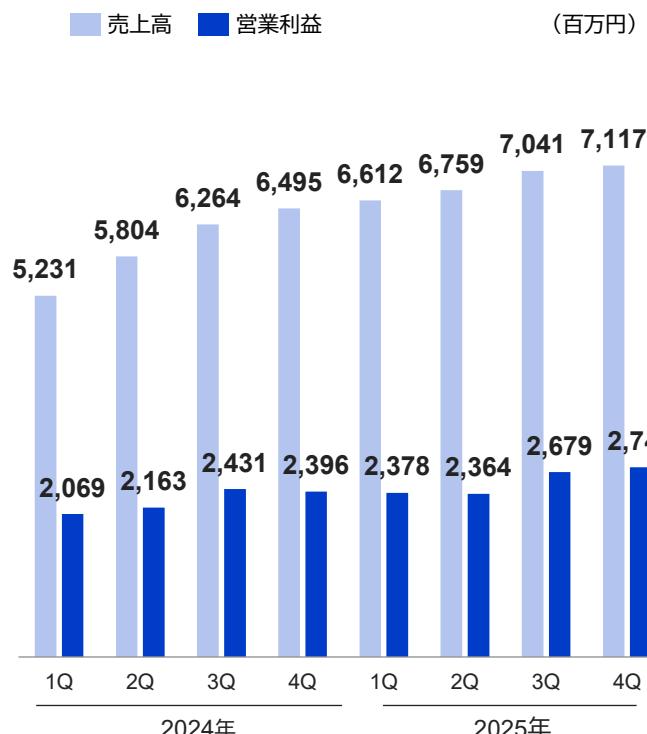
	ウェーハ再生事業		プライムウェーハ 製造販売事業		半導体関連装置・ 部材等事業		その他、調整額		連結合計	
		前同比		前同比		前同比		前同比		前同比
売 上 高	27,529	+15.7%	20,893	+2.2%	30,469	+87.1%	△2,185	-	76,707	+29.6%
営 業 利 益	10,167	+12.2%	4,159	△12.3%	1,624	+83.7%	△1,669	-	14,281	+8.9%
営 業 利 益 率	36.9%	△ 1.2pt	19.9%	△ 3.3pt	5.3%	△ 0.1pt	-	-	18.6%	△3.5pt

2025年12月期 セグメント別動向 四半期実績グラフ

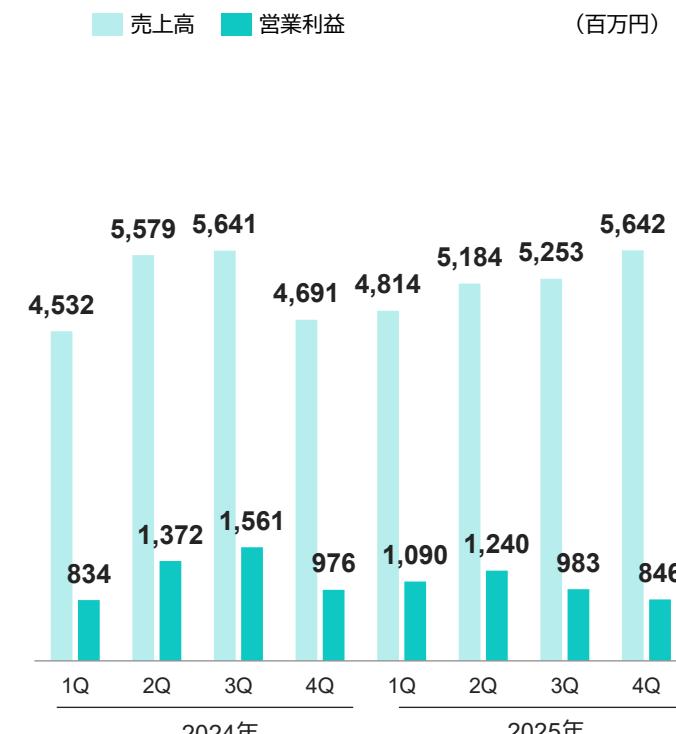


- ・ウェーハ再生事業は、良好な需要状況により、三本木及び台南工場はフル稼働、高い営業利益率を維持
- ・プライムウェーハ事業は、シリコン部材の中国顧客への拡販により出荷数量は増加するものの、単価低下が減益に影響
- ・半導体関連装置・部材等事業の売上高は前四半期に引き続きRSPDHがけん引

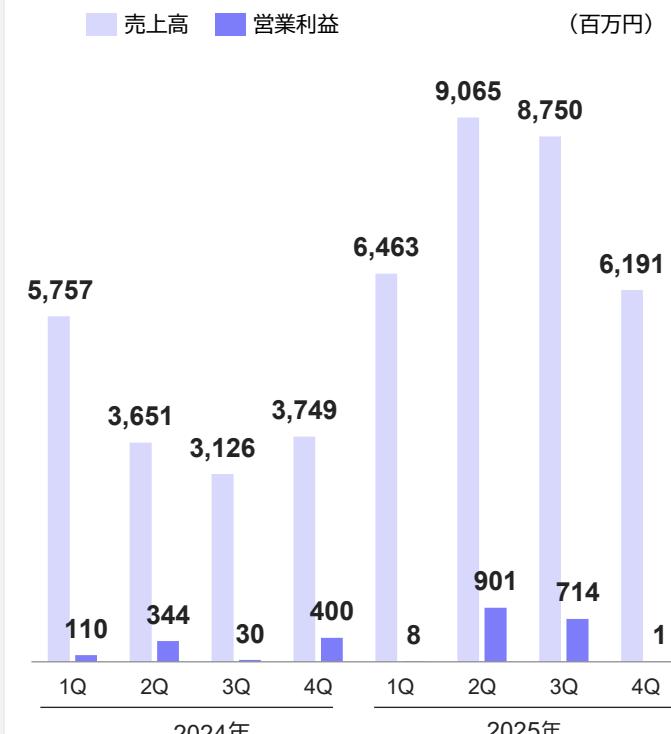
ウェーハ再生事業



プライムウェーハ事業



半導体関連装置・部材等事業



貸借対照表／キャッシュ・フロー



連結貸借対照表

	2024年12月期	2025年12月期	(百万円)
流動資産	124,894	135,354	
現金及び預金	85,224	96,771	
受取手形及び売掛金	23,417	22,322	
商品及び製品	6,678	5,677	
固定資産	57,252	69,867	
有形固定資産	45,575	49,485	
無形固定資産	689	669	
投資その他資産	10,987	19,712	
資産合計	182,146	205,222	
流動負債	34,804	31,286	
支払手形及び買掛金	8,302	9,890	
有利子負債	9,364	7,300	
固定負債	11,794	20,605	
有利子負債	2,915	16,140	
負債合計	46,598	51,891	
純資産	135,548	153,331	
負債・純資産合計	182,146	205,222	

D/Eレシオ	0.20倍	0.32倍
ネットD/Eレシオ	△0.55倍	△0.51倍

キャッシュ・フロー

	2024年12月期	2025年12月期	(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,143	14,836	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,630	△15,223	
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,964	10,302	
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,637	2,213	
現金及び現金同等物の増減額	14,114	12,128	
現金及び現金同等物の期首残高	69,645	83,759	
現金及び現金同等物の期末残高	83,759	95,888	

中期経営計画

02

中期経営計画 (2026-2028)



- この3カ年を成長加速に向けた集中投資フェーズと位置付け、ウェーハ再生事業へ大規模な資本投下を実施
- 2027年以降は、新規のM&Aを含めた成長を想定

	(百万円)	2024年 12月期 (実績)	2025年 12月期 (実績)	2026年 12月期予算	2027年 12月期予算	2028年 12月期予算
収益性	売上高	59,200	76,707	84,000	105,000	115,000
	営業利益	13,108	14,281	15,400	17,500	19,000
	営業利益率	22.1%	18.6%	18.3%	16.7%	16.5%
	経常利益	15,668	16,635	17,200	19,000	20,000
	経常利益率	26.5%	21.7%	20.5%	18.1%	17.4%
	親会社に帰属する当期純利益	9,446	9,297	10,000	11,500	13,000

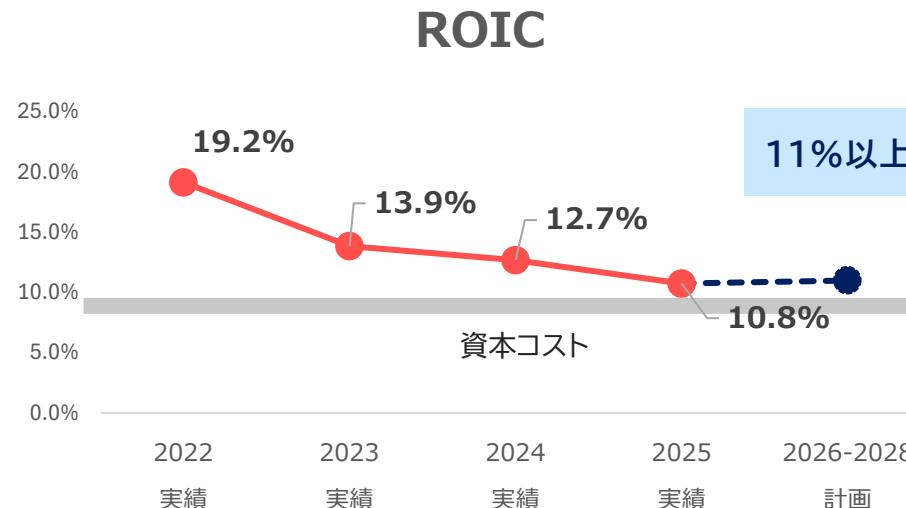
効率性	ROIC	12.7%	10.8%	11%以上
	ROE	15.2%	12.5%	13%以上

資本収益性と資本コスト(現状分析・評価)

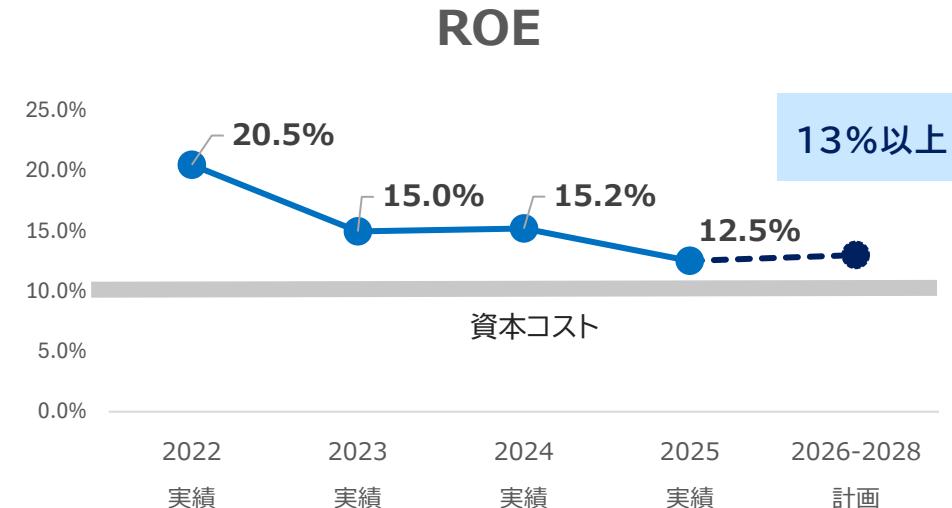


- 現在は投資先行局面にあるが、ウェーハ再生事業を中心とした大型投資の収益化や資本効率改善により、ROIC向上を目指す
- 2026年～2028年でROIC11%以上、ROE13%以上をターゲットに改善に向けた取り組みを実施予定

資本利益率



* $\text{ROIC} = \text{NOPAT} \div \text{投下資本} (\text{自己資本} + \text{有利子負債期首期末平均})$



* $\text{ROE} = \text{親会社に帰属する当期純利益} \div \text{自己資本期首期末平均}$

資本コスト

当社 WACC	9.0 %
---------	-------

* $\text{WACC} = \text{株主資本コスト} \times \text{株主資本} / (\text{投下資本}) + \text{負債コスト} \times \text{有利子負債} / (\text{投下資本}) \times (1 - \text{実効税率})$ を基に算出し、9.0%で設定

当社 株主資本コスト	10.5 %
------------	--------

*株主資本コスト = リスクフリーレート + ベータ値 × リスクプレミアムを基に算出し、10.5%で設定

*ROICの分母にあたる投下資本を(株主資本+有利子負債)から(自己資本+有利子負債期首・期末平均)に変更。ROEの計算式は有価証券報告書にあわせて分母を自己資本期首期末平均に統一

資本収益性向上に向けた取組み（キャッシュ・アロケーション）



- 高収益事業であるウェーハ再生事業への成長投資を加速させ、営業CFの最大化を図る

中国子会社Gritekの
株式一部を売却
(2026年2月10日開示)

再生ウェーハの生産
能力拡充による収益
拡大を主に、営業CF
の最大化を図る

キャッシュを有効活
用し、積極的な投資
を実施



安定的かつ継続的な株主還元

- 継続的な増配と配当性向の向上

M&Aの活用による事業成長の加速

- 半導体関連領域を中心に当社とのシナジー創出が可能な事業の取り込み
- 海外新規マーケット(欧米、東南アジア等)への進出
- 新規事業投資

高収益事業(再生ウェーハ)への積極投資

- 再生ウェーハ工場設備投資(日本・台湾・中国)：約405億円
- 再生ウェーハ最先端用途向け研究開発：約27億円
- 8インチプライムウェーハ設備投資：約38億円
- 自家消費型太陽光発電設備投資：約40億円
- エネルギー事業への設備投資：約60億円

資本収益性向上に向けた取組み (再生ウェーハへの大規模投資)



- ・3か年で、高収益事業であるウェーハ再生事業への投資を加速させ、さらなる市場シェア及び収益拡大を図る
- ・三本木第7工場再稼働、台南第2工場取得により、2028年までに累計生産能力を月産約120万枚まで拡充予定

■三本木工場

- ・2028年までに、第8工場は月産35万枚、第7工場は月産17万枚、計52万枚の量産体制を構築予定
- ・自動化の推進により、生産効率向上を計画
- ・最先端設備を導入し、幅広いニーズに対応予定

■台南工場

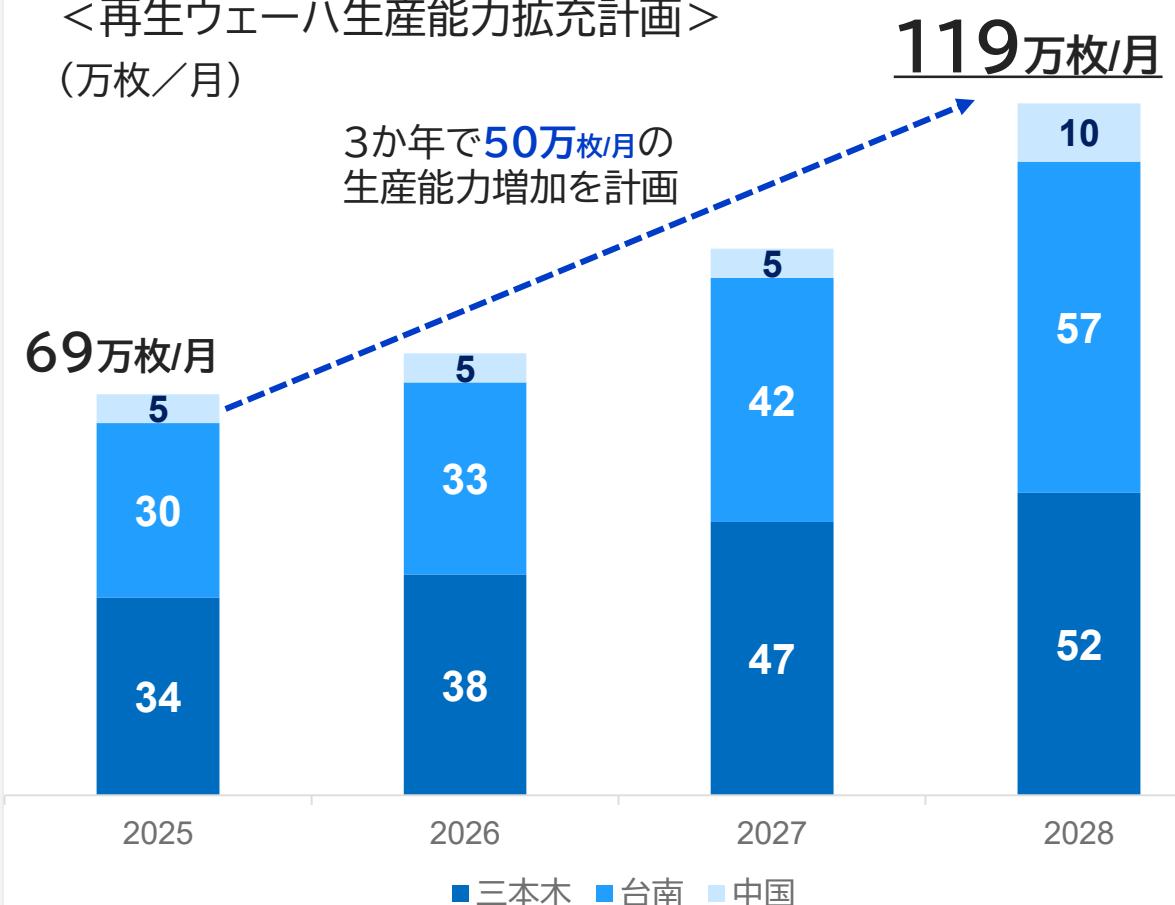
- ・2028年までに、第1工場は月産37万枚、第2工場は月産20万枚、計57万枚の量産体制を構築予定
- ・第2工場は、2030年までに最大キャパである月産30万枚体制を構築予定

■中国工場

2028年までに月産10万枚体制を構築予定

<再生ウェーハ生産能力拡充計画>
(万枚／月)

3か年で**50万枚/月**の
生産能力増加を計画





設備投資計画: ウエーハ再生事業

- ・2028年までに日本、台湾、中国の3拠点で世界の半導体需要を取り込むべく大規模投資を実施
- ・月産119万枚の生産能力を確立し、さらなるシェア拡大を図る

日本

総投資額 **173億円+**

投資額

2026年度	2027年度	2028年度
119億円	54億円	未定

■ 12インチ再生ウェーハ生産能力(月産)

	2026	2027	2028
第8工場	34万枚	35万枚	35万枚
第7工場	4万枚	12万枚	17万枚
計	38万枚	47万枚	52万枚

台湾

総投資額 **247億円**

投資額

2026年度	2027年度	2028年度
28億円	124億円	95億円

■ 12インチ再生ウェーハ生産能力(月産)

	2026	2027	2028
第1工場	33万枚	37万枚	37万枚
第2工場	-	5万枚	20万枚
計	33万枚	42万枚	57万枚

中国

総投資額 **100億円**

投資額

2026年度	2027年度	2028年度
-	-	100億円

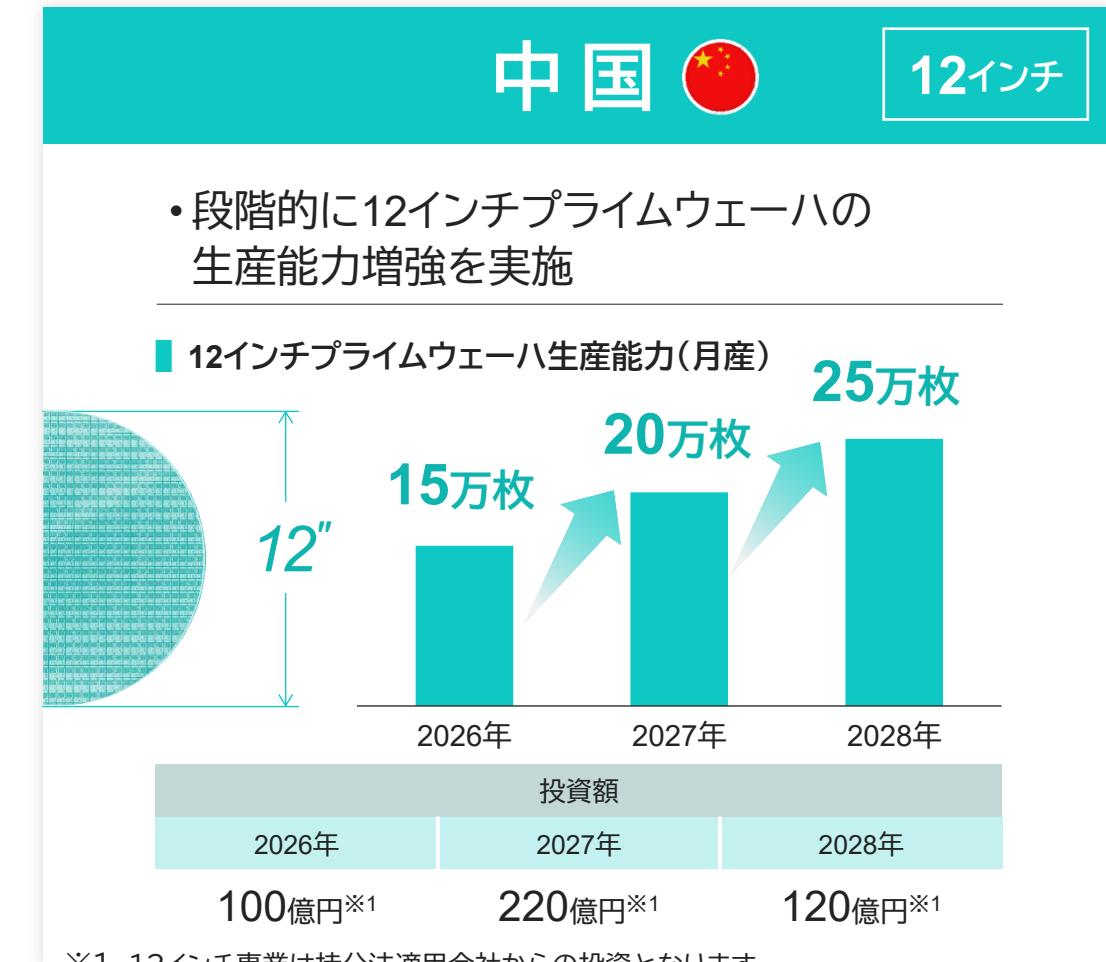
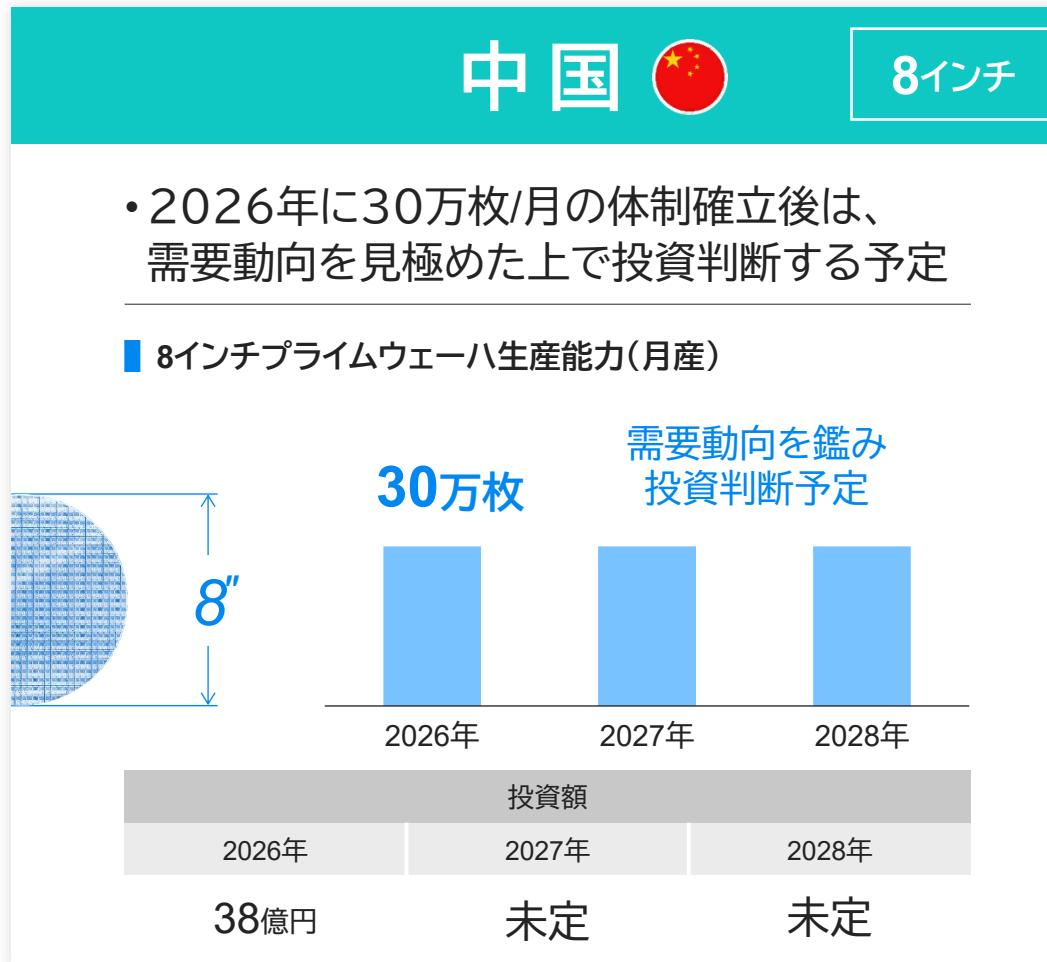
■ 12インチ再生ウェーハ生産能力(月産)

	2026	2027	2028
中国工場	5万枚	5万枚	10万枚
計	5万枚	5万枚	10万枚

設備投資計画: プライムウェーハ事業

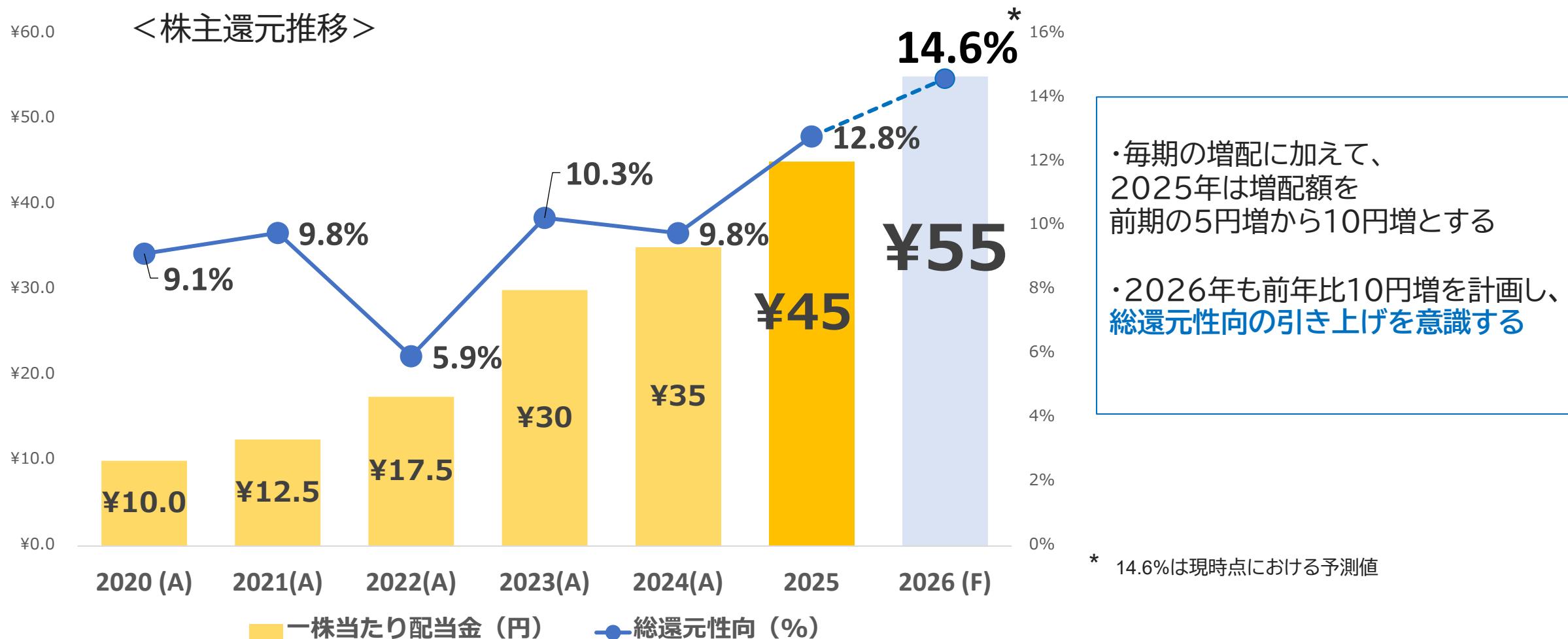


- ・8インチプライムウェーハは、2026年中に30万枚/月の生産能力確立。2027年以降の投資は需要動向を見極め判断
- ・12インチプライムウェーハは、2028年中に25万枚/月の生産能力確立し、中国プライムウェーハ市場に本格参入予定



資本収益性向上に向けた取組み（株主還元）

- ・2025年度の一株当たり配当額は、前期35円から10円増配の45円/株（配当性向12.8%）
- ・2026年度の一株当たり配当金は、55円を想定



- 今後も企業価値向上につながるIR活動を推進予定

◆ 役員のIR活動への関与

- IR部門による面談に加え、経営方針や戦略についてより理解を深めていただくため、役員自ら投資家様と対話する機会を積極的に設定

◆ 海外IRの強化

- 海外投資家からの面談数の増加に伴い、海外IRも強化（2024年は欧州のノンディールロードショーを実施）
- 決算・適時開示情報の英文同時開示や英文サイトの充実化により、国内、海外の情報非対称性解消に向けた取組みを強化



◆ 個人投資家へのアプローチ

- 個人投資家へのプレゼンス拡大に向けて、IRフェアやセミナー等、イベントに積極参加

RS Technologies

の目指す世界

一歩一歩、着実に事業領域および
販売地域を広げていく

事業

成長拡大



→ 地域

M&Aターゲット



- ・事業規模拡大に向け、M&Aを実施
- ・「半導体」、「エネルギー」、「新規事業」がM&Aのターゲット

<M&Aターゲット領域>



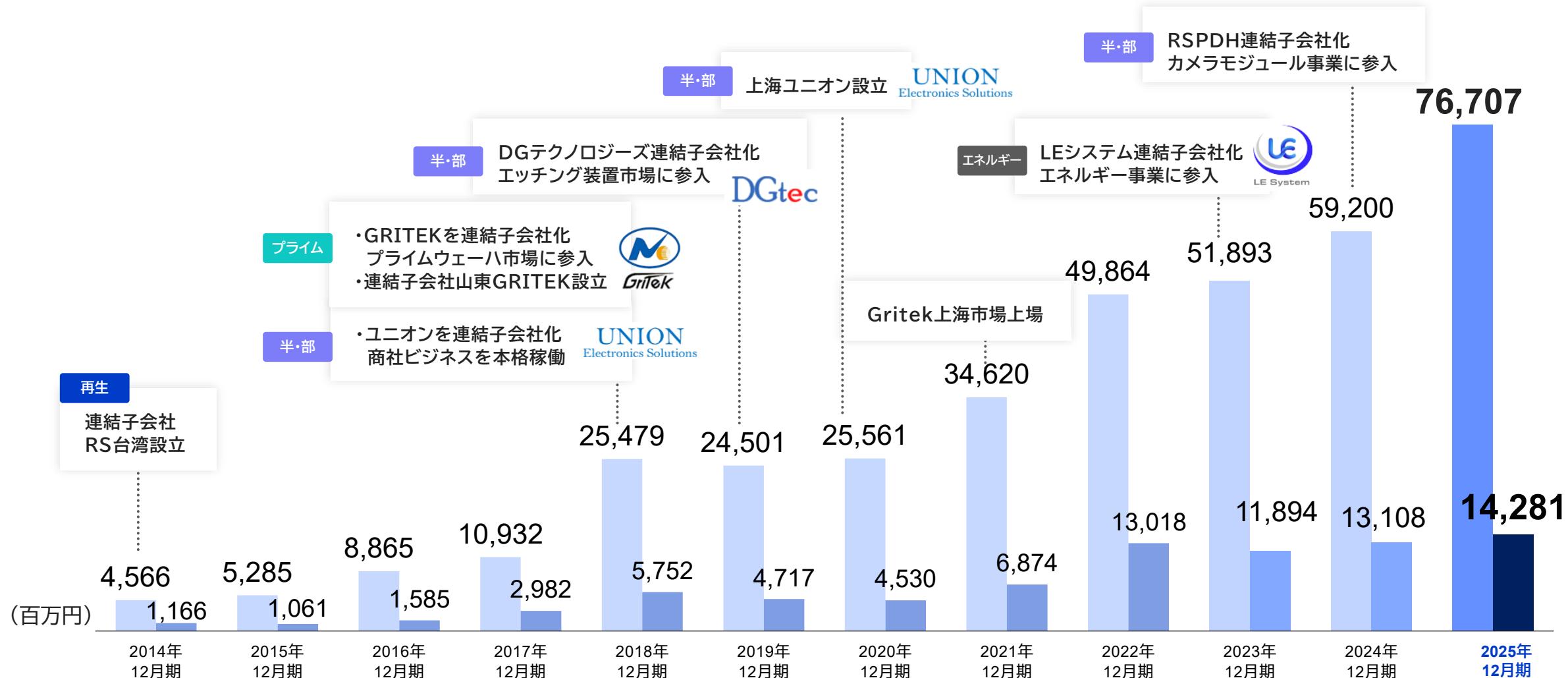
<投資判断基準>

- ◆ 投資基準(ハードルレート)÷利回り14~20%
- ◆ シナジー効果を重視したターゲット選定
- ◆ 新規事業において成長性のある市場の選定

M&A実績と売上高推移



・積極的なM&Aを中心とした成長戦略により、CAGR売上高29.2%、営業利益27.4%を達成



会社概要

03



- ・ウェーハ再生事業で世界市場シェア31%のトップ企業^{※1}
- ・中国中央企業^{※2}との合弁事業でプライムウェーハ事業に進出
- ・M&Aによりシナジーの期待できる周辺事業領域に事業を拡大

社名	株式会社RS Technologies
設立	2010年12月10日
経営理念	「地球環境を大切にし、世界の人々に信頼され、常に創造し挑戦する。」
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・シリコンウェーハの再生加工・販売 ・プライムウェーハの製造・販売 ・半導体製造装置向け消耗部材の製造・販売 ・超音波映像装置・電子部品の販売 ・エネルギー関連事業 ・カメラモジュールの製造・販売 等
本社所在地	東京都品川区大井1-47-1 NTビル
製造拠点	宮城県、茨城県、福島県、台湾、中国
資本金	5,860百万円(2025年12月末時点)
代表取締役	方 永義

※1 SEMIデータに基づき弊社にて推計

※2 国有企業のうち、中央政府の管理監督を受ける企業

※3 2025年12月末現在

主な 連結子会社	有研半導体硅材料股份公司(GRITEK)	登録資本 10億人民元
	艾爾斯半導體股份有限公司(RS台湾)	出資比率 40.21% ^{※3} 上場 上海証券取引所科創板
株式会社 DG Technologies	株式会社 ユニオンエレクトロニクスソリューション	資本金 NT \$300 million 出資比率 100%
	株式会社 LEシステム	資本金 100百万円 ^{※3} 出資比率 100%
艾索精密部件(惠州)有限公司	株式会社 ユニオンエレクトロニクスソリューション	資本金 27百万円 出資比率 100%
	株式会社 LEシステム	資本金 30百万円 出資比率 100%
艾索精密部件(惠州)有限公司	株式会社 ユニオンエレクトロニクスソリューション	資本金 555百万人民元 出資比率 100%
	株式会社 LEシステム	資本金 30百万円 出資比率 100%

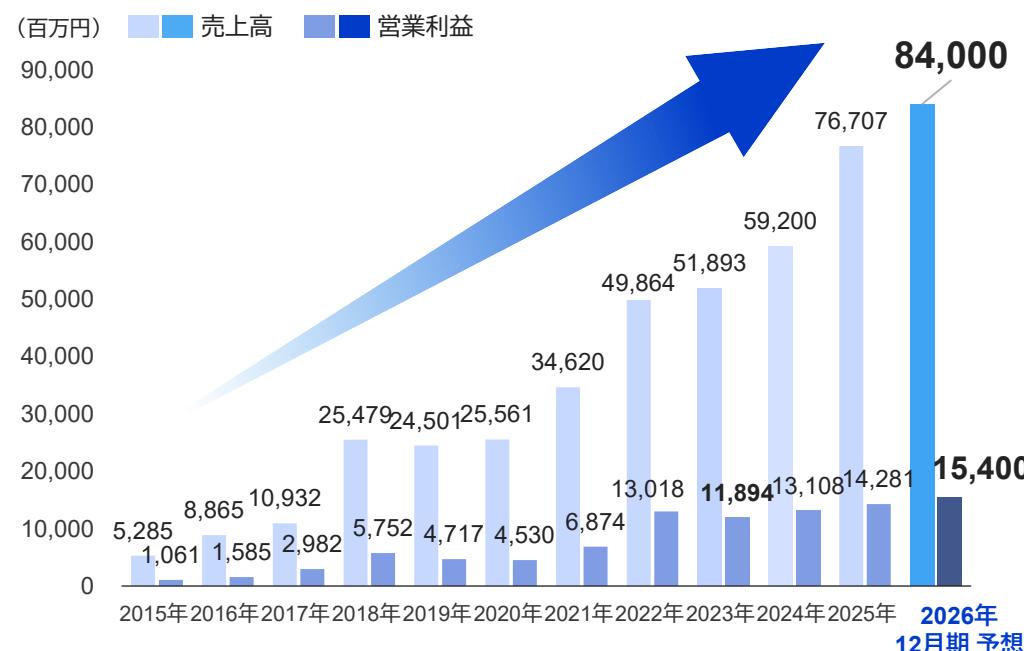
- ・設立以来、ウェーハ再生事業における世界トップ企業として確固たる地位を確立
2018年に中国の大手プライムウェーハメーカーを連結子会社化したこと、ウェーハ総合メーカーに

2010年 12月	ウェーハ再生事業を主たる事業として株式会社RS Technologiesを設立	再生
2014年 2月	台湾に艾爾斯半導體股份有限公司(連結子会社)を設立	再生
2015年 3月	東京証券取引所マザーズに株式を上場	
2016年 9月	東京証券取引所市場第一部(東証一部)へ市場変更	
2018年 1月	中国プライムウェーハ製造メーカーである有研半導体材料有限公司(GRITEK)を連結子会社化	プライム
2018年 5月	株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューションの100%株式を取得(日立パワーデバイスの特約店)	半・部
2018年 8月	山東有研半導体材料有限公司(GRITEKの連結子会社。山東GRITEK)を設立	プライム
2019年 1月	株式会社DG Technologies(DG)の100%株式を取得	半・部
2020年 2月	上海悠年半導体有限公司(上海ユニオン)を設立	半・部
2022年 4月	東証一部からプライム市場へ移行、指名報酬委員会(任意)を設置	
2022年 11月	GRITEKが上海証券取引所科創板市場へ上場	プライム
2023年 12月	「VRFB用の電解液製造事業を展開するLEシステムを連結子会社化	エネルギー
2024年 11月	中国廈門市に艾斯科技(廈門)有限公司(現 連結子会社)を設立	
2024年 12月	光学モジュール・車載カメラモジュール事業を展開する艾索精密部件(惠州)有限公司を連結子会社化	半・部

再生	ウェーハ再生事業関連
プライム	プライムウェーハ事業関連
半・部	半導体関連装置・部材等事業
エネルギー	エネルギー関連

- ・ウェーハ再生事業+プライムウェーハ事業の総合ウェーハメーカー
- ・半導体関連装置・部材等事業など事業領域を拡大
- ・ウェーハ再生事業はグローバルシェアNo1、プライムウェーハ事業では中国国内向けを中心に事業を展開

連結売上高および営業利益



セグメント別売上高

半導体関連装置・
部材等事業

約**305億円**
約39%



プライムウェーハ
製造販売事業

約**209億円**
約26%

ウェーハ再生事業
約**275億円**
約35%

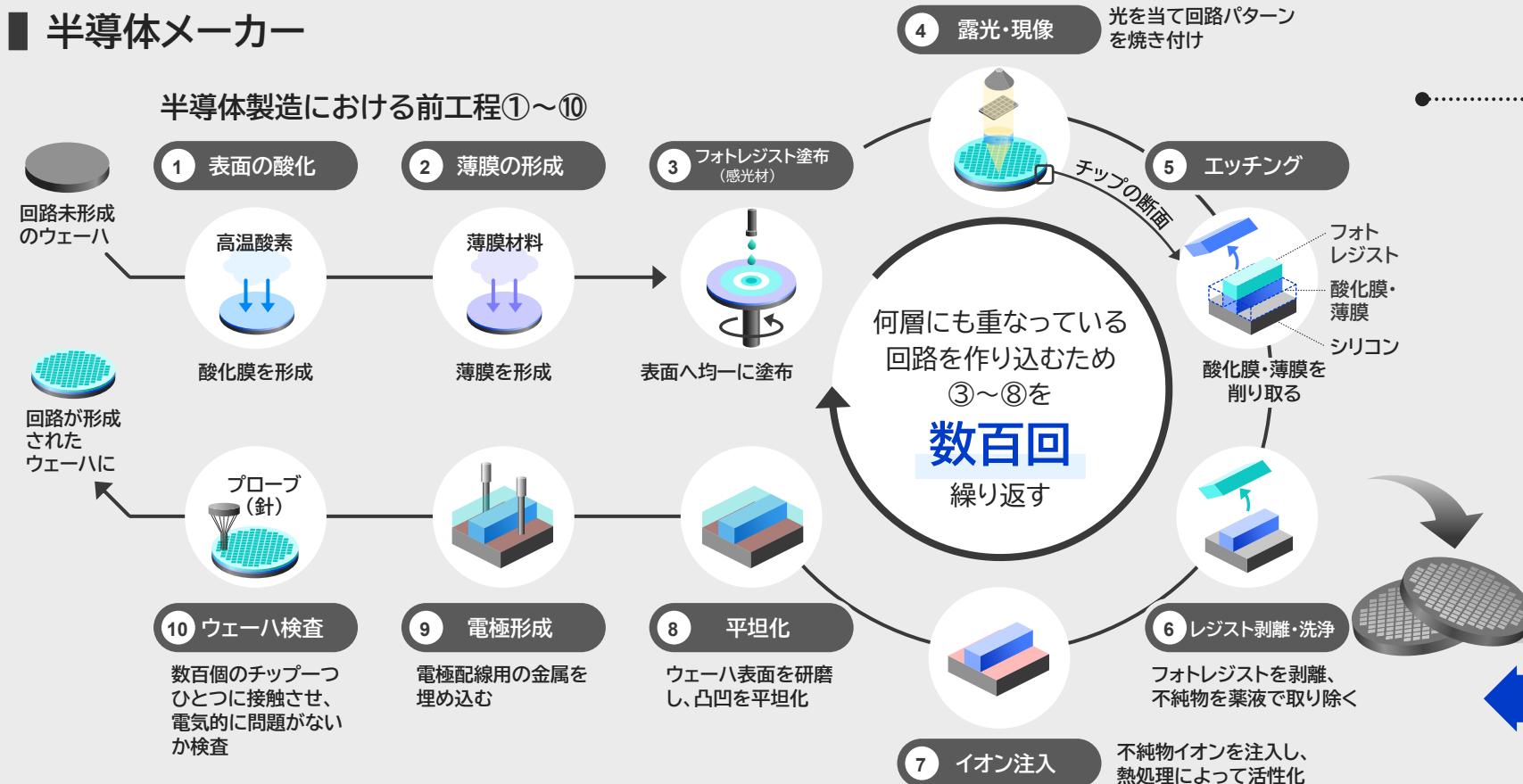
再生ウェーハとは



- ・再生ウェーハとは、主に半導体製造において使用されるテストウェーハを再生加工したウェーハのこと
- ・再生したウェーハは繰り返し使用されるが、当社独自技術では、10回以上のリサイクルも可能であり、**環境負荷軽減**に加え、半導体メーカーの**コストダウン**にも貢献

■ 半導体メーカー

半導体製造における前工程①～⑩



■ 当社

ほぼ全ての工程で使用される

- ・モニターウェーハ(用途:プロセスや加工精度の評価)
- ・ダミーウェーハ(用途:精密加工の安定性向上)

当社はそれらを再生し、半導体メーカーへお戻ししている

再生加工 (再利用できる状態にクリーニング)

半導体製造のためには、
ウェーハの再生が必要不可欠

使用済みのウェーハを回収

出荷

顧客資産を加工

ウェーハ再生事業について



- 再生ウェーハ業界におけるグローバルサプライヤーとして、継続的な業績拡大を実現

市場の特徴

半導体業界の継続的な成長

世界の半導体市場規模は、2025年から2030年にかけてCAGR:約8%で成長し、2029年には**1兆米ドル**に達すると予測されている※1

※1出所:SEMIジャパン



景気変動に強い

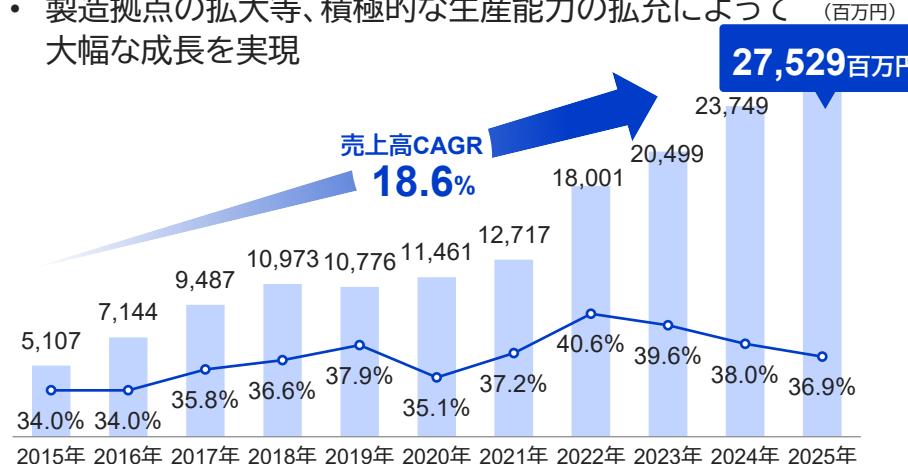
- 製造装置の立上げ等多用途に利用される
- 不況時に顧客のコスト意識が高まると、再生ウェーハ投入量が増える
- シリコンサイクルの影響を受けにくい**

今後も継続的な成長が見込める

実績

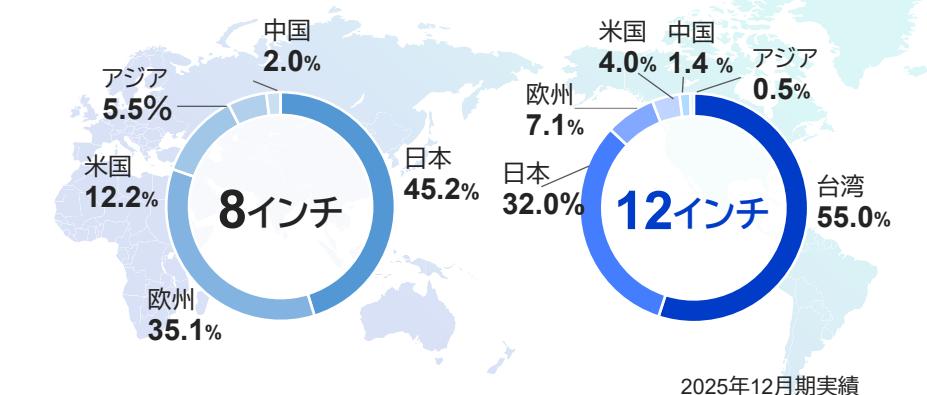
業績推移

- 製造拠点の拡大等、積極的な生産能力の拡充によって大幅な成長を実現



地域別出荷構成

- 日本・台湾・欧州・北米と幅広い出荷先を確保
- 地域分散、業種分散によってリスクヘッジも図っている



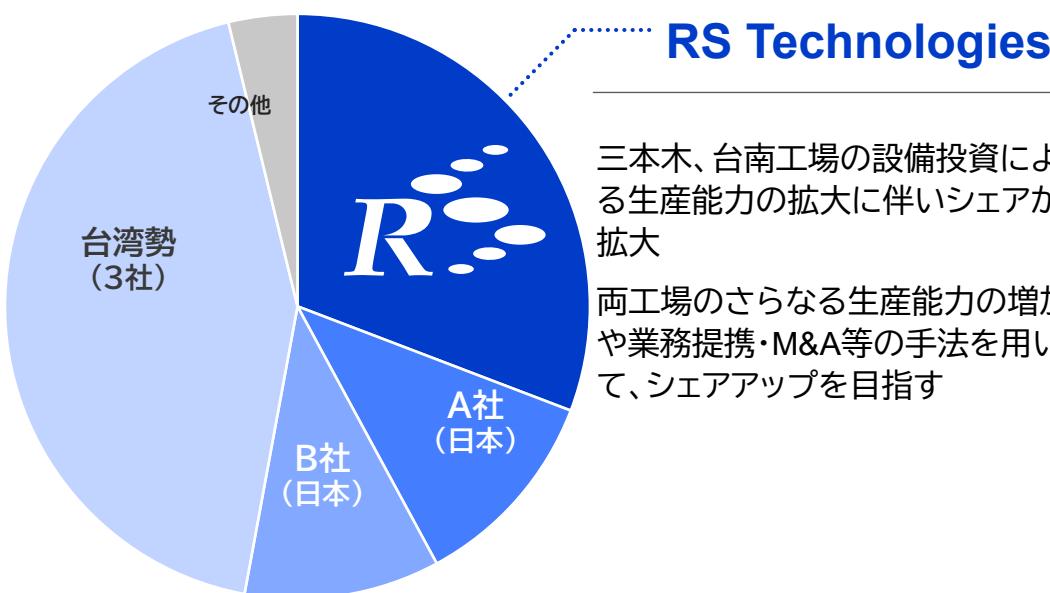
再生市場における当社のシェア



再生市場での当社のシェア拡大

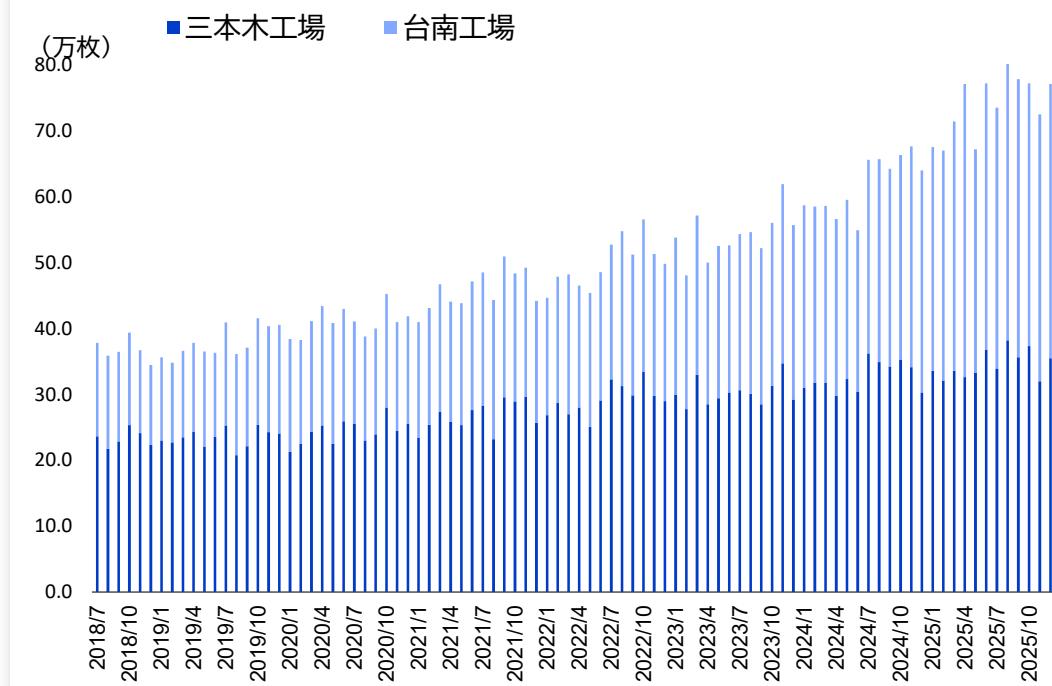
■ 12インチ再生市場における当社シェア

グローバルシェア No.1 (約31%)

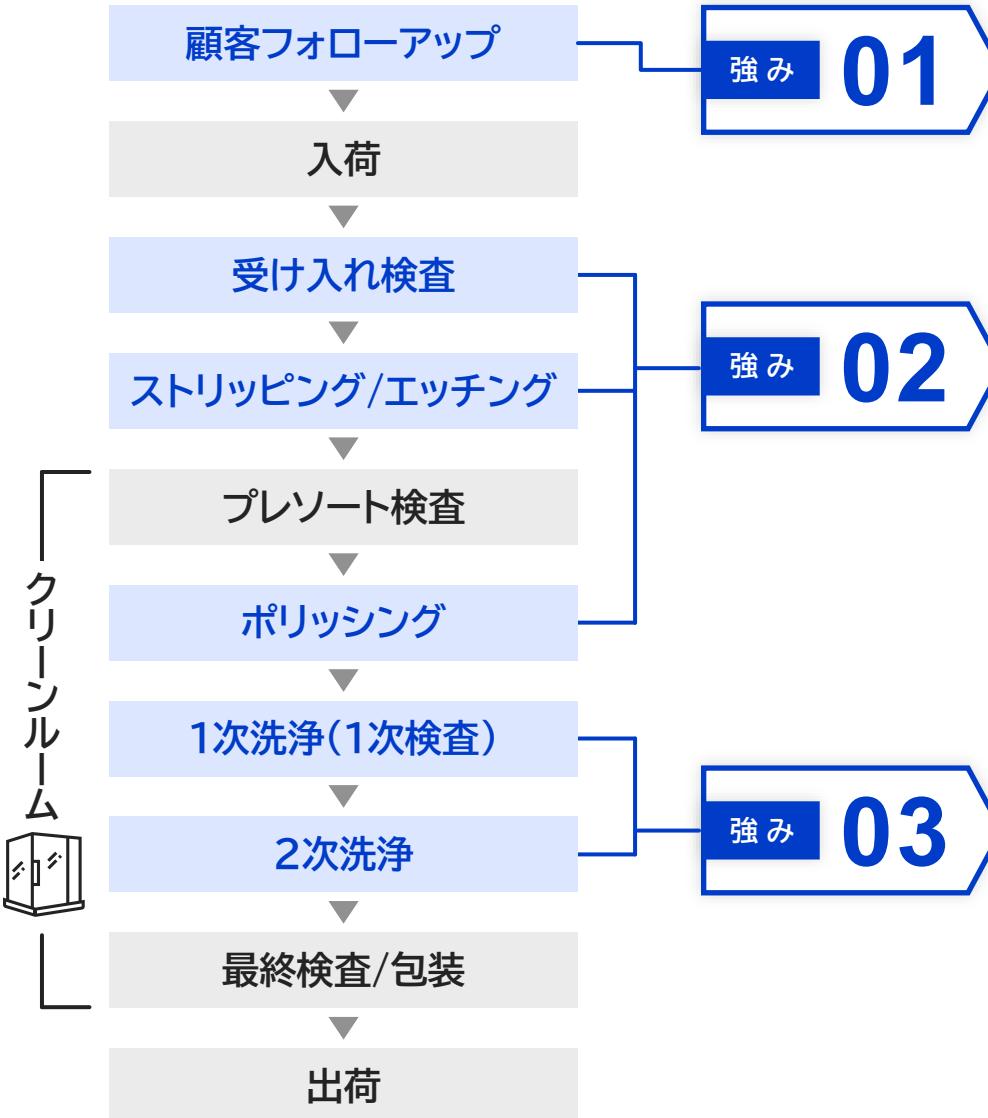


三本木工場と台南工場の出荷推移

■ 三本木工場と台南工場の12インチウェーハ出荷枚数推移



当社再生の強み



直販体制による正確なニーズの把握

全ての顧客と直接コミュニケーションを行い、
東京本社で管理することにより圧倒的なコストダウンを実現

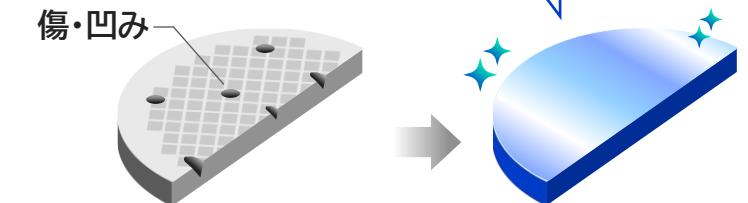
すべての膜を剥離可能

ケミカル処理の為、表面のダメージが最小限に

再生回数が多い

よりコストダウンが可能

ラサ工業(化学)の
独自技術を継承



表面に付いているキズや凹凸を研磨(ポリッシング)により平滑にする

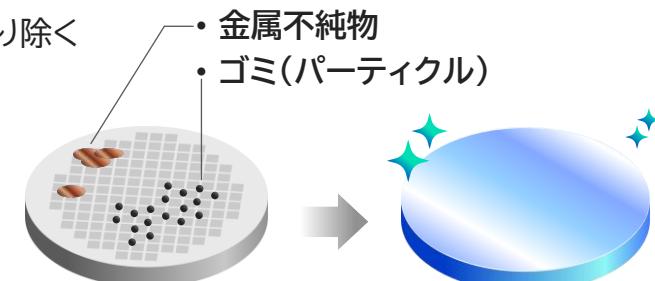
金属不純物を除去

ウェーハ表面の微細ゴミ・汚れを洗浄で取り除く



金属不純物を除去

特に銅(Cu)の除染除去に強み



ウェーハ再生事業の需要先: 12インチ半導体“新”工場

- 世界市場では、中欧米日等で12インチ半導体新工場建設プロジェクトが進行中
- 当社は、日本、台湾及び中国への設備投資により、新たな再生ウェーハ需要へ対応



注: RST調べ

売上高構成



- セグメント内再生ウェーハ、販売ウェーハの割合は、7:3程度が継続

収益構造

ウェーハ再生事業 売上高

再生加工賃収入

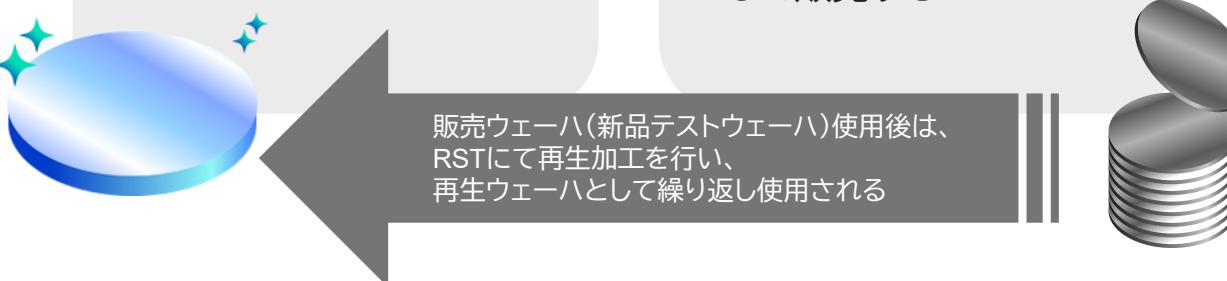
(加工単価×出荷枚数)

半導体工場から使用済みテストウェーハをお預かりし、クリーニング(再生加工)を行い、同じ工場にお戻しする

販売ウェーハ売上高

(販売単価×販売枚数)

市場よりスペックアウトしたテストウェーハを買取り、RSにて磨き上げ、需要のある半導体工場に新品テストウェーハとして販売する



売上高内訳

(百万円)

■再生 ■販売

(27,528)

(20,498)

6,010

14,488

2023/12期

(23,793)

7,911

15,882

2024/12期

9,423

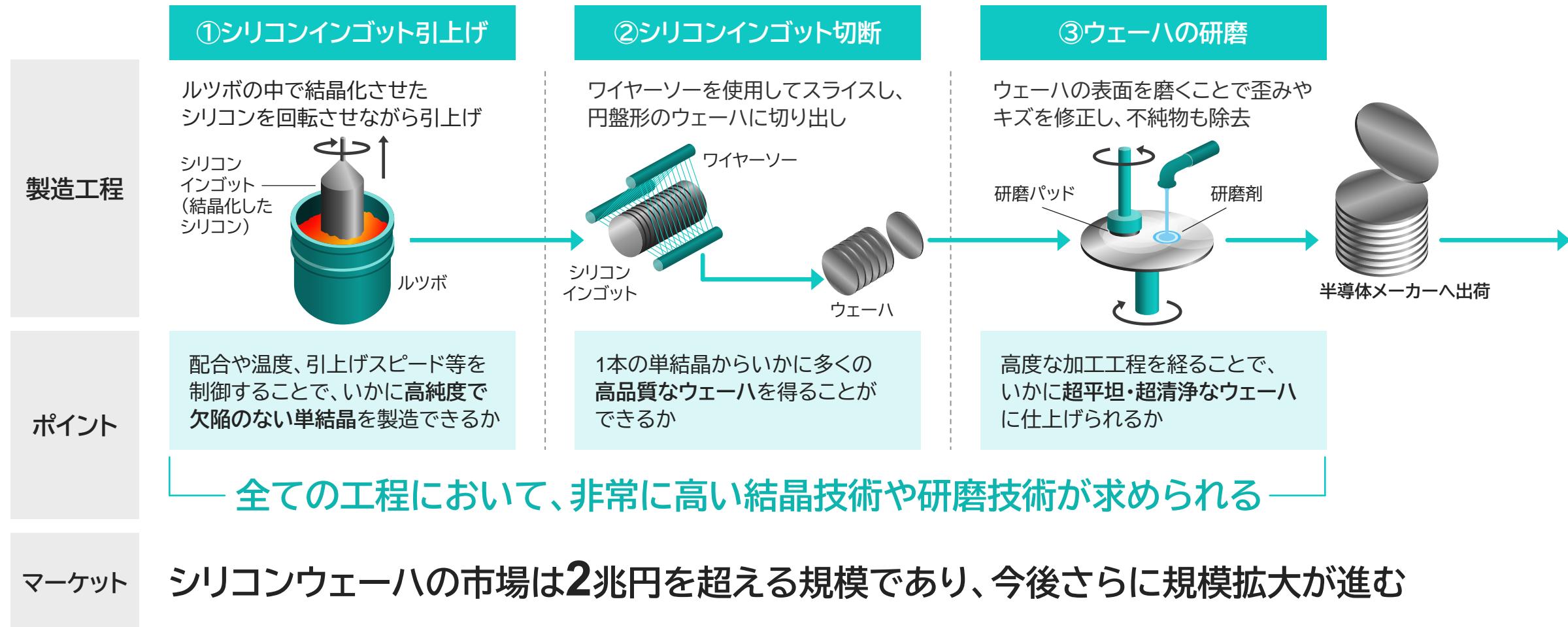
18,105

2025/12期

プライムウェーハとは



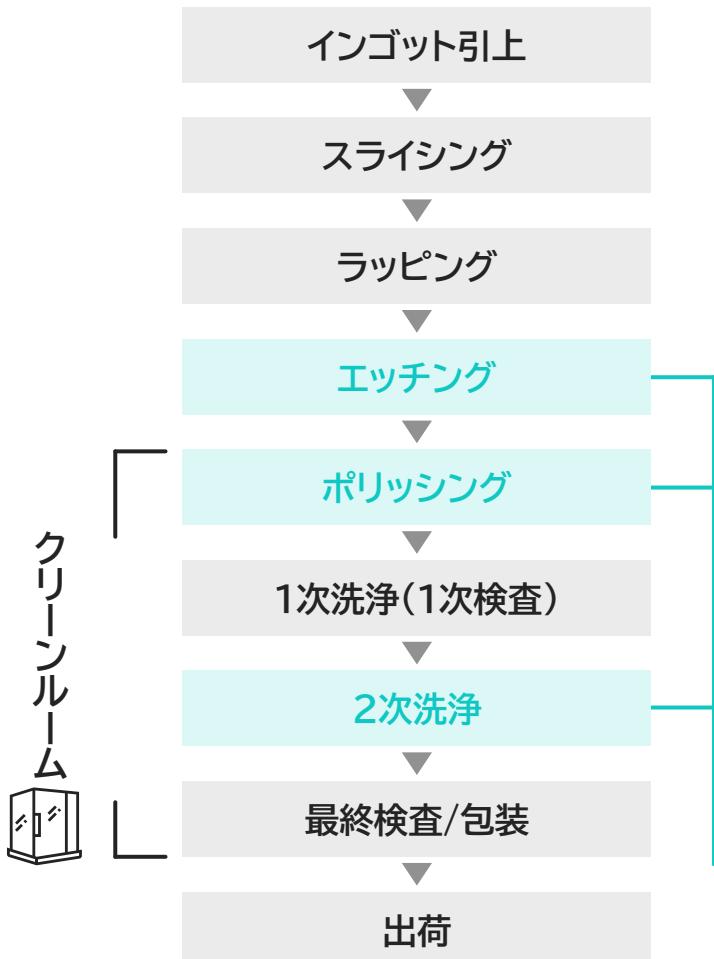
- ・プライムウェーハとは、半導体の基板材料であるシリコンウェーハのこと
- ・イレブンナイン(純度99.99999999%)のシリコンを用いており、非常に高い平坦度のウェーハに加工する事業



プライムウェーハビジネスへの進出について



- 中国中央企業※1の有研科技集團有限公司(Grinm)と事業会社である有研半導体材料有限公司※2(Gritek)を設立



当社とGrinmとのシナジー効果

強み 01

Gritekの持つ技術力



強み 02

中国半導体施策の恩恵を享受



強み 03

RSのグローバルな販売網で全世界顧客へ販売



強み 04

RSの再生加工技術を活用

30年以上に及び当社の知見・見識あり



有研科技集團有限公司
(Grinm)

1952年創立:中国の非鉄金属分野で最大の国有研究機関
約4,100名の従業員のうち、約2,000人の研究者が在籍

当社のプライムウェーハ事業



- ・2018年、中国の非鉄金属分野で最大の国有研究機関である有研科技集團有限公司(Grinm)と合弁し、有研半導体材料有限公司※1(Gritek)を連結子会社とすることにより参入。中国山東省にフラッグシップ工場を竣工
- ・Gritekは2022年、上海証券取引所科創板市場に上場した



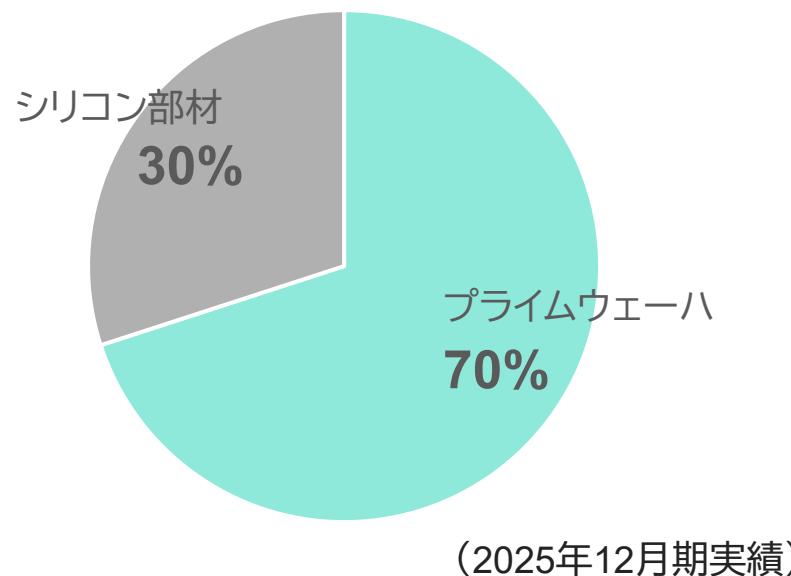
※1 現:有研半導体硅材料股份公司

売上高構成



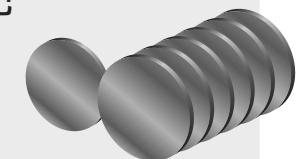
- 中国の半導体市況の回復基調を背景に、2024年度から、プライムウェーハ比率が上昇

プライムウェーハ事業売上構成イメージ



商品概要

■ プライムウェーハ 5, 6, 8インチ合計
・中国国内のEpi HOUSEや半導体メーカーに販売



■ シリコン部材(エッチング装置の消耗部材)
・グローバルの加工メーカーへ販売
(エンドユーザーはエッチング装置メーカーや半導体工場)

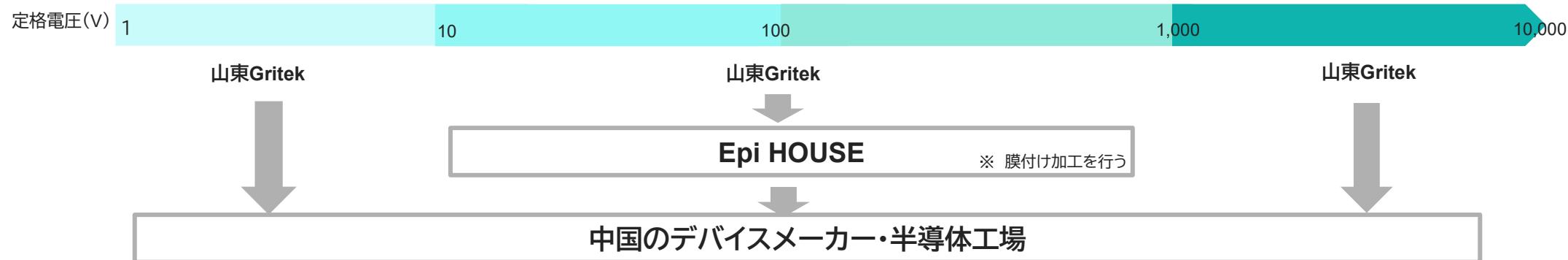


8インチプライムウェーハ商流と売上構成イメージ



- Gritekは、プライムウェーハ市場の中ではニッチな分野を強みとするため、高い利益率が継続
- 中国政府の経済活性化に向けた取組みの1つである家電購入時の補助金を追い風に、パワー半導体需要は増加傾向

■Gritek 8インチウェーハの主な商流イメージ



■使用用途イメージ



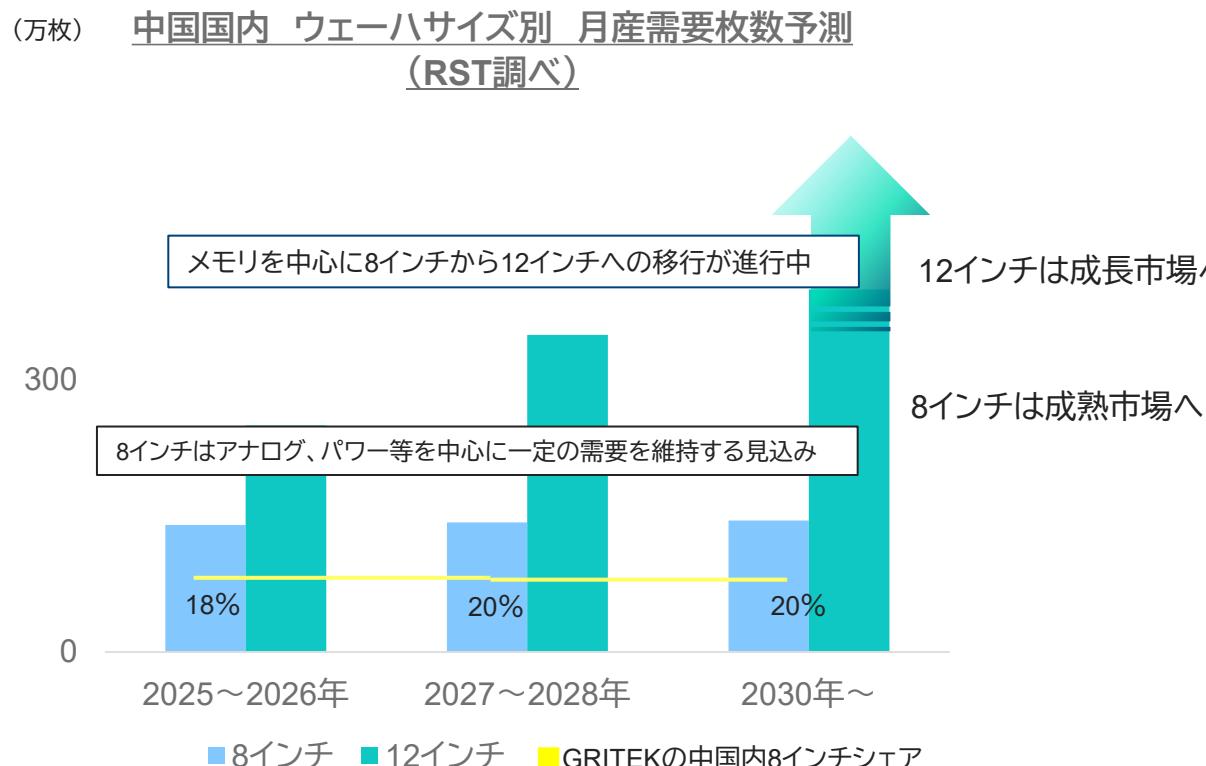
■Gritek 8インチウェーハの売上高構成イメージ(2025年12月期)



中国プライムウェーハ戦略(市場予測)



- 8インチの需要枚数は、2028年まで緩やかに増加すると予測
- 12インチ市場は急拡大中であり、2030年の需要枚数は月産400万枚を超えると予測



【2028年までの戦略】

8インチ

Gritekの強みである高電圧パワー半導体向けの新製品開発、
増産投資を強化

[⇒2027年以降は、中国内シェア20%を目指す](#)

12インチ

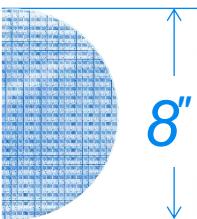
量産体制を構築し、中国国内のプライムウェーハ出荷数を増加させる
[⇒中国12インチ市場にてシェア7%を目指す](#)

中国プライムウェーハ戦略(事業動向と重点施策)



事業動向

GRITEK



ニッチ分野に特化し高収益経営を実現

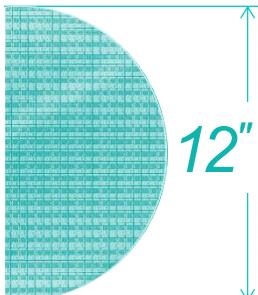
- 中国内の8インチ全体の市場成長は鈍化傾向であるものの、Gritekの強みである8インチパワー半導体向けウェーハは堅調に推移
- 12インチの台頭により、IGBTやメモリ用途といった規格品ウェーハを中心に、単価は低下傾向

重点施策

生産効率向上により高収益を維持

- 新商品の開発にも積極的に投資し競争力を強化
- 継続的な生産管理の見直しにより、生産効率を向上させ、高水準の営業利益率を維持

SGRS



顧客からの認定取得を着実に進め、量産出荷を見据える

- SGRSは、Gritekの技術移管により、パワー半導体向け12インチウェーハの認証取得が先行して拡大
- 市場のボリュームゾーンであるポリツシドウェーハの認証獲得も着実に進歩
- 中国競合各社が、過剰投資による莫大な損失を抱えながら運営の中、SGRSは、損失を抑えながら研究開発、設備投資を推進中

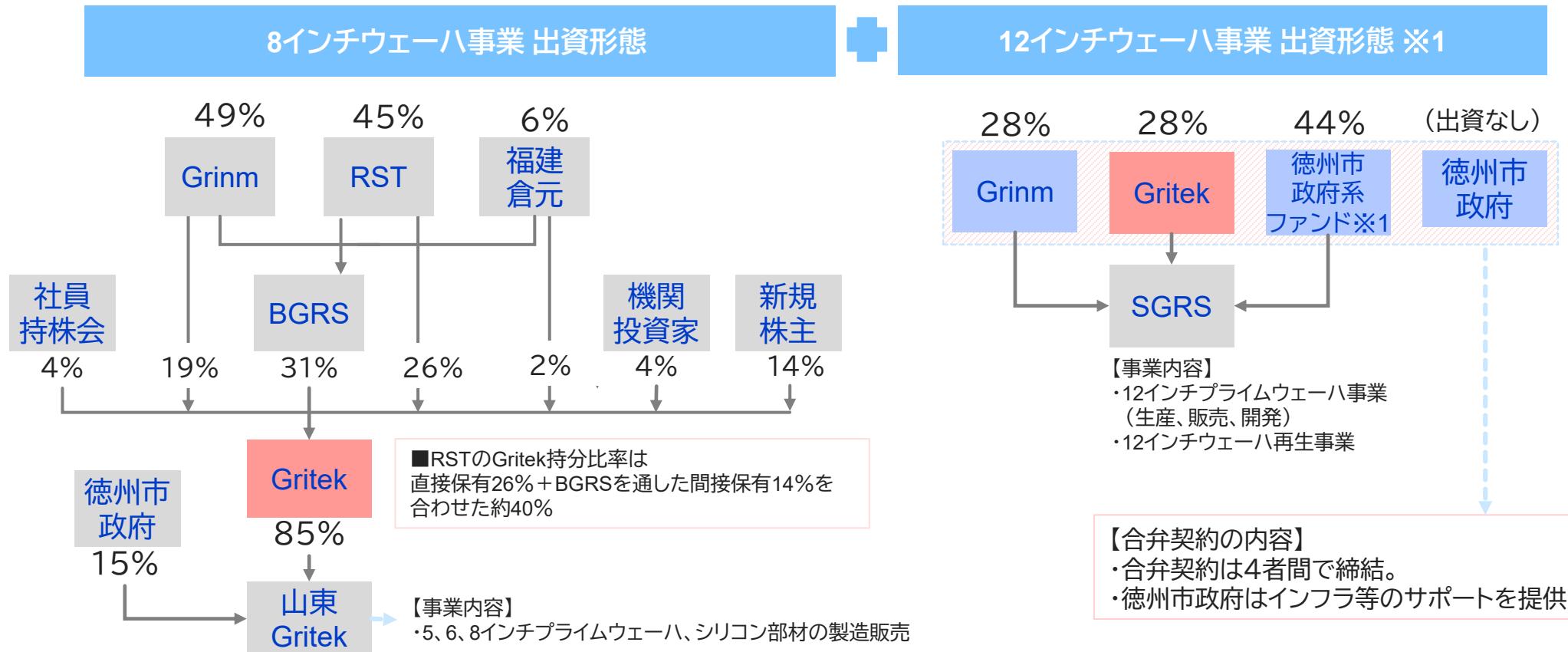
市場動向を見極めた投資計画により着実に生産枚数を拡大

- Gritekの技術力を移管したパワー半導体向けに加えて、ボリュームゾーンであるポリツシドウェーハの認証取得も進める
- 量産出荷を見据え、設備投資、人材確保を強化

プライムウェーハ事業への出資スキーム



- GRITEKは上海証券取引所科創板に上場(SHA: 688432)
- 当社だから可能な中国政府系ファンドを巻き込みリスクコントロールしたモデル

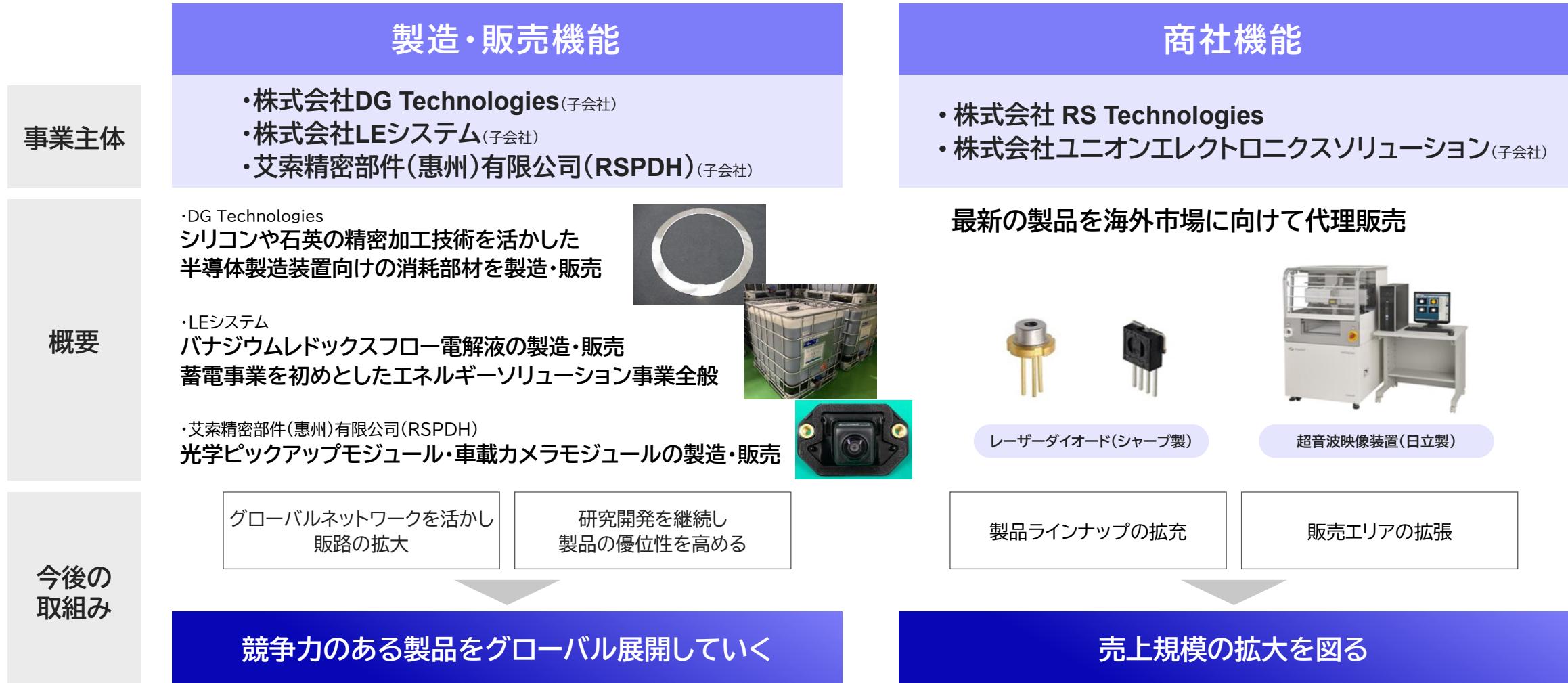


2025年12月末時点

半導体関連装置・部材等事業について



- 製造販売機能と商社機能を展開するセグメント



エネルギー事業



- 2023年12月、M&Aによりエネルギー事業に参入、2025年6月には中国にてVRFB用電解液事業を展開するRS能源を設立

【エネルギー事業のコアミッション】



- RSテクノロジーズのグループ総合力を活用したトータルエネルギーソリューションカンパニーとなる
- 安全性・長寿命に優れたVRFB電解液の安定供給を通じて、持続可能な環境社会実現の一翼を担う

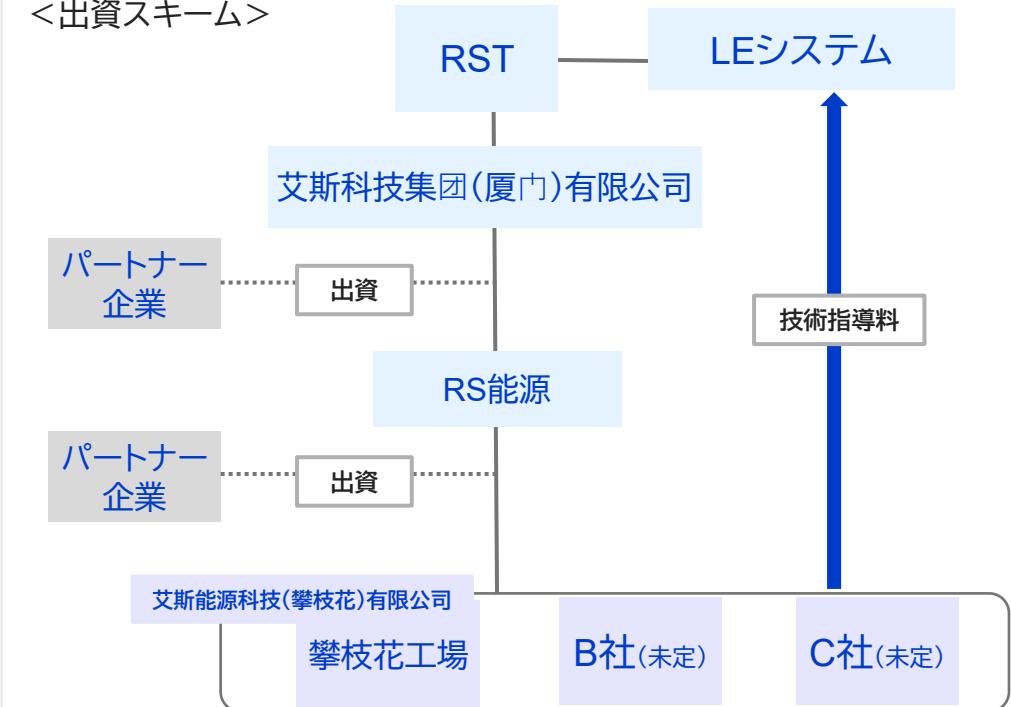
<会社概要>

社名	株式会社LEシステム／艾斯能源(山東)有限公司(略称:RS能源)
設立	2023年10月13日(事業承継日:2023年12月／2025年6月)
事業内容	VRFB用電解液、電気料金最適化コンサルティング等
所在地	東京都品川区大井1-47-1NTビル (株式会社RS Technologies内)
製造拠点	浪江工場(福島県)、攀枝花工場(中国四川省)※建設中
代表者	大澤 一生

(LEシステム)

- 2023年12月より、旧LEシステムの事業を全面的に承継
- 旧LEシステムの基幹技術は日本で生まれた技術であり、株式会社INCJ(官民ファンド)の出資を含む多くの支援を受けてきた

<出資スキーム>



中長期の展望(エネルギー事業)



- ・2026年の事業開発段階を経て、中長期的にはトータルエネルギーソリューション企業として、グループの中核を担う事業に発展させるため中長期戦略を推進中

事業領域	第1フェーズ2023～	第2フェーズ2026年～	第3フェーズ2029年～
VRFB用電解液	VRFB用電解液	【中核事業の確立】 VRFB用電解液の製造販売 自社製造(浪江、攀枝花他)	
VRFB全般	VRFBシステム	【事業拡大】 電解液／蓄電商材販売 ・VRFBシステム(セル)卸販売 ・蓄電製品卸販売 ・電解液用材料製造販売	
エネルギー関連	エネルギー商社		
	蓄電開発		
エネルギー ソリューション	アグリゲーター	【長期戦略】 蓄電総合ソリューション 蓄電所運営	
	蓄電池ソリューション		

エネルギー事業(バナジウムレドックスフロー電池とは)



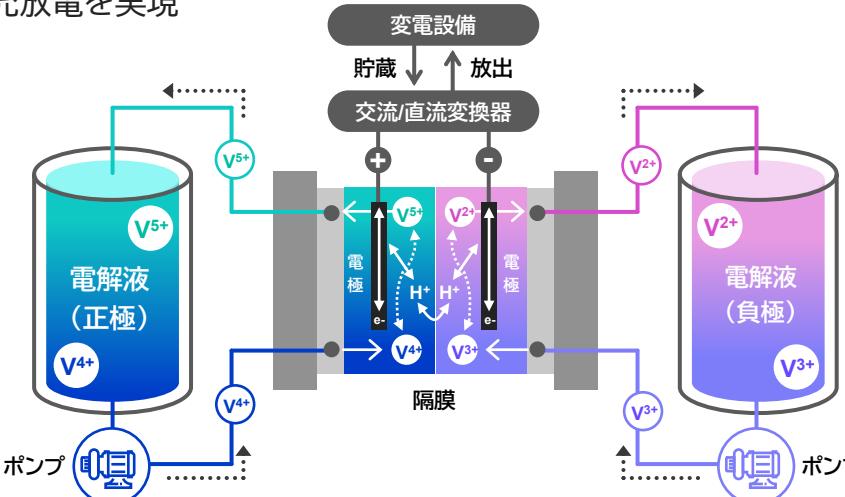
- VRFB(バナジウムレドックスフロー電池)は、バナジウムを用いた電解液を循環・化学反応させることで充電と放電を行う蓄電池
- LEシステムでは、このVRFB用電解液を製造・供給している

主要用途

風力発電や太陽光発電等、大規模・大容量の定置式蓄電池としての活用

仕組み

他の蓄電池が電極の化学変化で充電と放電を行うのに対し、ウォーターバッテリー用電解液の化学変化(酸化還元)による充放電を実現



特徴

充電と放電回数に制限がなく劣化がないことから長期の安定稼働が可能であり、安全性も高く、再生エネルギーとの相性も良い



VRFBは大容量の定置式蓄電池として高い安全性と
安定供給が求められる風力・太陽光発電等に最適な特徴を有する

エネルギー事業(国内市場動向)



- 2025年2月18日経済産業省が決定した「GX2040ビジョン」達成に向けて、
LEシステムではVRFBの社会実装に向けた取り組みを継続

～GX2040ビジョンとは～

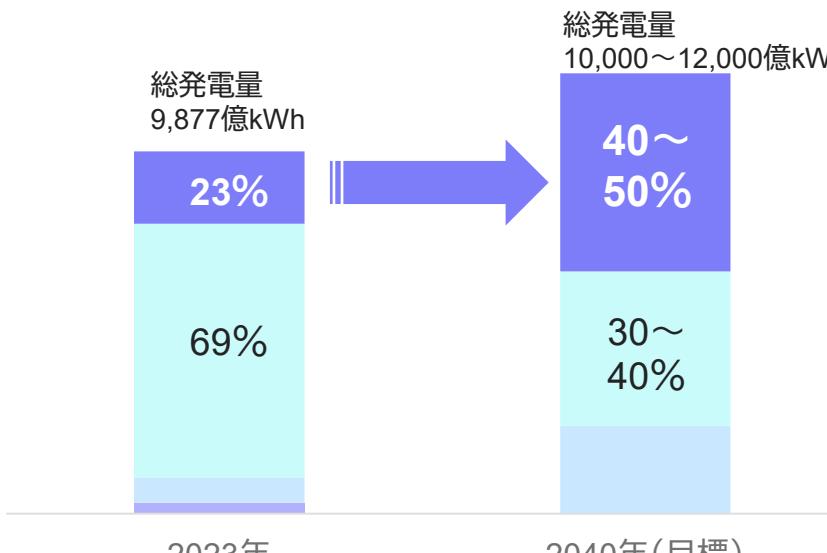
GX2040ビジョンとは、日本が2040年までに脱炭素社会を実現し、持続可能な経済成長を目指すための戦略的ビジョンです。

第7次エネルギー基本計画である“2040年度の温室効果ガス73%削減(2013年度比)に向け、再生可能エネルギーを40～50%程度として初の「最大電源」に位置づける”ための具体的な実施計画です。



【日本のエネルギー構成】

再生可能エネルギーは、2023年から約3,200億kWh増加見込み
=安定供給のため蓄電池の需要が拡大



■その他 ■原子力 ■火力 ■再生可能エネルギー

【エネルギー政策の大原則“S+3E”】

安全性(Safety)

+

安全供給
(Energy Security)

経済効率性
(Economic Efficiency)

環境適合
(Environment)

【“S+3E”を満たすVRFBを展開するLEシステムの取組み】

2040ビジョン達成に向けた重要課題の1つ
「再生可能エネルギーの安定供給」に、
大型蓄電システムVRFBの貢献チャンスを見込む

エネルギー事業(中国市场動向／事業進捗)



- 2025年6月に中国のエネルギー関連孫会社「艾斯能源(山東)有限公司」(RS Energy (Shandong) Co.,Ltd.)を設立
- パートナー企業との合弁事業として、中国国内に電解液のマザープラントとして攀枝花工場を建設中

中国市场動向

2025年中国VRFBプロジェクト情報

■ VRFB新規設置規模

4,179 MWh

■ 容量前年比

+140%

出所:各種資料よりRST調べ

2026年1月28日 攀枝花工場の竣工式を開催
2026年中の稼働開始を目指す



艾索精密部件(惠州)有限公司(RSPDH)



- 2024年12月、M&Aにより光学ピックアップモジュール・車載カメラモジュールの製造販売事業を承継
- 既存事業である光ピックアップモジュールに加え、新たに車載カメラモジュール事業を立ち上げ、更なる事業拡大を目指す
- 中国マーケットにおける当社の強みを活かし、販路拡大を見込む



社名	艾索精密部件(惠州)有限公司
設立	1995年11月20日(事業承継日:2024年12月)
資本金	555百万元
事業内容	光学ピックアップモジュール・車載カメラモジュールの製造・販売
所在地	中国広東省惠州仲恺高新区

地域戦略

日本・北米・欧州

三本木工場(日本旗艦工場)が北米、欧州、日本等を中心にカバー



取締役の体制

- ・ガバナンス体制強化のため2022年3月に監査等委員会設置会社に組織形態を変更

社内取締役



方 永義
代表取締役社長
1998年 永輝商事設立
2010年 当社設立社長就任(現任)
DG Technologiesの代表取締役社長、
台湾、中国の子会社の董事長を兼任



遠藤 智
取締役上席執行役員
製造部長
1991年 ラサ工業入社
2011年 当社入社
2017年 当社取締役就任(現任)
DG Technologies取締役、
台湾、中国の董事を兼任



大澤 一生
取締役上席執行役員
2006年 永輝商事入社
2012年 当社入社
2023年 当社取締役就任(現任)
LEシステム代表取締役社長を兼任



戸松 清秀
取締役上席執行役員
経営管理本部・経営戦略本部部長
2020年 きらぼし銀行入行
2023年 当社入社
2024年 当社取締役就任(現任)
艾索精密部件(惠州)有限公司董事長を兼任

独立社外取締役

伊澤 太郎 取締役

1981年 凸版印刷入社
同社取締役、常務取締役を経て
2024年 当社取締役就任(現任)

金森 浩之 取締役監査等委員

1988年 監査法人朝日親和会計社社入所
2022年 当社取締役就任(現任)
金森公認会計士事務所所長、
みなど公認会計士共同事務所代表、
上場企業の社外取締役を兼任

清水 夏子 取締役監査等委員

2005年 弁護士登録
2022年 当社取締役就任(現任)
清水・新疆法律事務所開設共同弁護士、
上場企業の社外取締役を兼任

張 翠萍 取締役監査等委員

2004年 中国法律登録
2011年 外国法事務弁護士(中国法)登録
2024年 当社取締役就任(現任)
西村あさひ法律事務所・
外国法共同事業パートナーを兼任

代表取締役 方永義の強み

- ・代表取締役社長である方永義が20年以上にわたって日本で培った知見と自身が持つネットワークを生かした
全世界への販売力・人脈力・提携力・資金力 が強み
- ・方永義の下にハイテクや金融など幅広い分野のプロフェッショナル人財が集結



方 永義 (ほう ながよし)

- ・1970年生まれ 中国福建省出身
- ・城西国際大学院 経営学博士
- ・1998年 永輝商事設立
- ・2010年 当社設立社長就任(現任)
- ・2014年 日本に帰化

得意分野

M&A、業務提携

大切にしている心

為せば成る

補足

- ・高校卒業後に来日。「半導体事業」の他、ファンドや貿易、ホテル、IT事業、農業等様々な業界の投資を経験
- ・「日本のものづくりは世界一」との信条の元、それを世界に広めていくため、世界中を飛び回っている

Appendix

04

三本木工場 (RS Technologies、ウェーハ再生事業)



- ・2011年1月 操業開始、2015年6月 最先端設備を導入した第8工場にて生産開始
- ・半導体市況の成長が加速する中、強まる需要に対応するために、第7工場への設備投資を決定
- ・第7工場は、2026年中に稼働開始予定



社 名	株式会社RS Technologies
製 品	5,6,8,12インチ再生ウェーハ
生 产 能 力	8インチ：月産15万枚 12インチ：月産34万枚 第7工場増産計画(月産)：2026年4万枚、 2027年12万枚、2028年17万枚
所 在 地	宮城県大崎市
認 証	ISO9001、ISO14001

台南工場（RSTW、ウェーハ再生事業）



- 2015年12月、艾爾斯半導體股份有限公司(RSTW)台南工場生産開始
- 2027年～、台南第2工場が稼働予定



社名	艾爾斯半導體股份有限公司
設立	2015年12月
製品	12インチ再生ウェーハ
生産能力	12インチ：月産30万枚 第2工場増産計画(月産)：2027年5万枚、 2028年20万枚、2029年25万枚、2030年30万枚
所在地	台湾台南市
認証	ISO9001、ISO14001

德州工場（山東Gritek、8インチプライムウェーハ事業）

- 2018年8月、山東有研半導体材料有限公司(Gritekの連結子会社、山東Gritek)を設立
- 2020年10月、新工場が竣工を迎え、プライムウェーハの新たな製造拠点として稼働開始

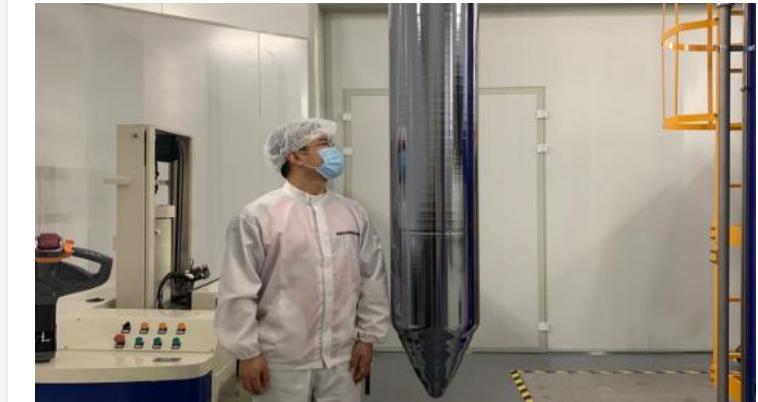


社名	山東有研半導体材料有限公司
設立	2020年10月
製品	5,6,8インチプライムウェーハ
生産能力	5インチ：月産5万枚 6インチ：月産20万枚 8インチ：月産25万枚
所在地	中国山東省德州市
認証	ISO9001、ISO14001

SGRS研究開発センター(SGRS、12インチプライムウェーハ事業)

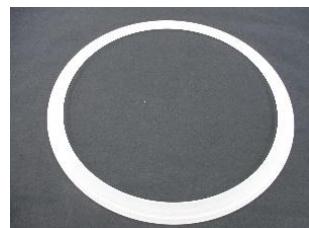


- ・2020年3月、持分法適用子会社 山東有研RS半導体材料有限公司(SGRS)を設立
- ・2021年に月産1万枚の開発ラインを設置→2021年から12インチプライムウェーハの研究開発及び生産を開始



社 名	山東有研RS半導体材料有限公司
設 立	2020年3月
製 品	①12インチプライムウェーハ ②12インチ再生ウェーハ
生 産 能 力	①月産10万枚、開発ライン月産1万枚 ②月産5万枚
所 在 地	中国山東省德州市

- 2021年5月、宮城県に栗原工場を立ち上げ
- 従来からの生産拠点である神栖工場と栗原工場(新設)の2拠点体制で、増加する受注に対応



社名	株式会社DG Technologies
稼働開始	2021年5月
製品	ドライエッティング装置向け 石英・シリコン製消耗部材
所在地	宮城県栗原市
認証	ISO9001、ISO14001

社名	株式会社DG Technologies
設立	1981年10月
製品	ドライエッティング装置向け 石英・シリコン製消耗部材
所在地	茨城県神栖市
認証	ISO9001、ISO14001

浪江工場（LEシステム、半導体関連装置・部材等事業）



- 2023年12月、当社が旧LEシステムの電解液製造事業※1を全面的に承継

※1 旧LEシステムの基幹技術は日本で生まれた技術であり、株式会社INCJ(官民ファンド)の出資を含む多くの支援を受けてきた



社名	株式会社LEシステム
設立	2023年10月13日(事業承継日:2023年12月)
事業内容	バナジウムレドックスフロー電池の電解液製造
生産能力	年間約5,000m ³
所在地	福島県双葉郡浪江町(工場) 茨城県つくば市(事業所)

業績推移



(百万円)	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
売上高	8,864	10,932	25,478	24,501	25,561	34,620	49,864	51,893	59,200	76,707
売上総利益	2,544	4,252	8,366	7,940	8,681	11,870	18,432	17,413	19,380	23,585
販管費	958	1,269	2,615	3,223	4,151	4,995	5,413	5,519	6,271	9,303
営業利益	1,585	2,982	5,751	4,717	4,530	6,874	13,018	11,894	13,108	14,281
経常利益	1,444	3,159	6,141	5,416	5,252	8,832	15,500	14,921	15,668	16,635
当期利益(※1)	861	2,113	3,620	3,035	2,824	3,303	7,739	7,703	9,446	9,297
配当金(円) (※2)	10	5	10	15	20	25	35	30	35	45
設備投資	209	95	1,328	4,809	12,409	7,827	5,379	5,999	8,786	8,419
減価償却費	682	714	1,298	1,814	1,674	2,942	3,498	3,774	4,199	5,547
研究開発費	85	183	501	449	929	1,308	1,657	1,764	1,647	1,916
従業員数 (正社員)(人)	373	434	1,159	1,277	1,187	1,333	1,533	1,534	2,614	2,744

(※1)親会社株主に帰属する当期純利益 (※2)2023年度の配当は2023年1月1日の分割(1/2)後にて表示

主要財務諸表



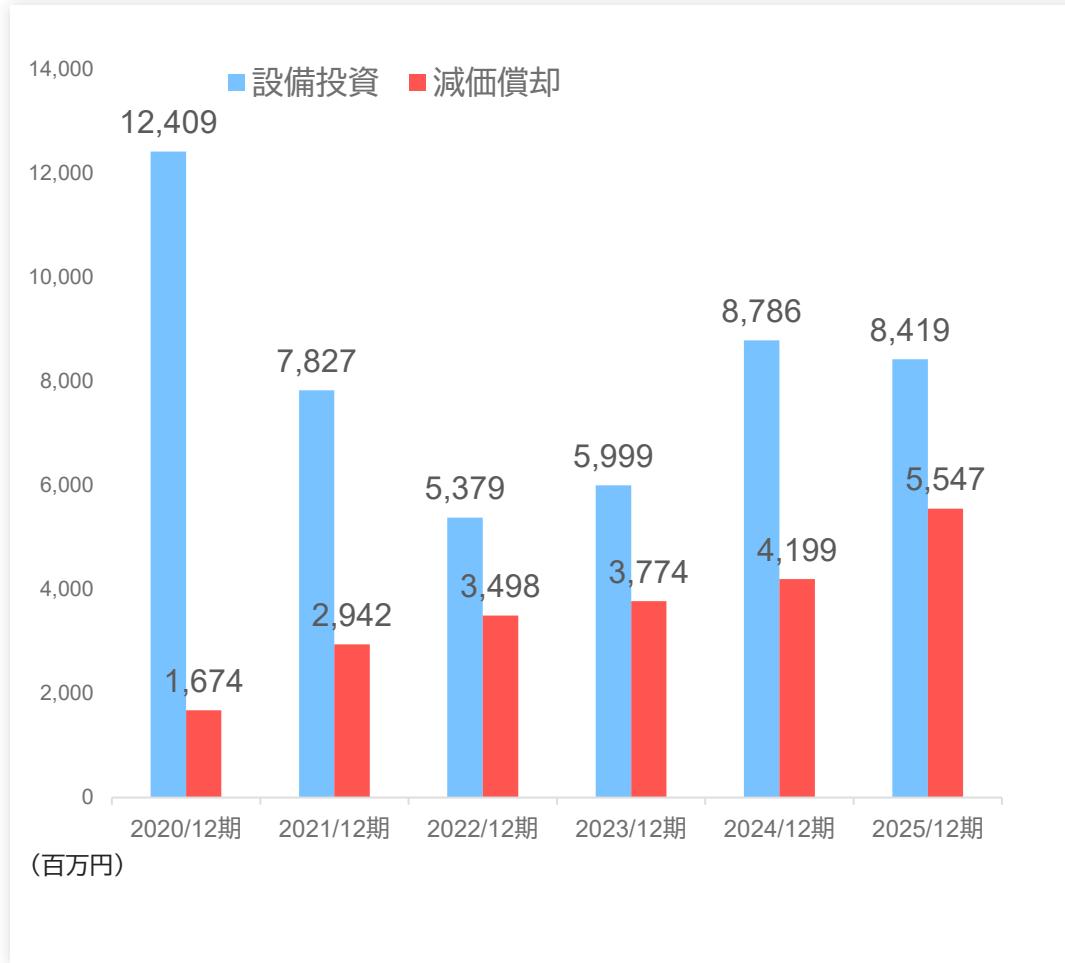
(百万円)	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
資産の部										
流動資産	5,348	7,388	26,074	32,760	32,626	45,804	90,470	96,409	124,894	135,354
現金及び預金	1,952	3,243	14,879	22,156	19,082	25,438	67,939	70,758	85,224	96,771
受取手形及び売掛金	2,531	2,916	6,958	6,047	6,321	9,517	11,651	12,673	23,417	22,322
商品及び製品	348	446	1,343	1,713	2,116	2,783	3,833	6,507	6,678	5,677
固定資産	5,333	4,843	10,516	15,873	26,124	33,206	37,084	44,256	57,252	69,867
有形固定資産	5,152	4,674	8,963	14,635	24,146	29,023	31,285	35,326	45,575	49,485
無形固定資産	23	19	1,099	732	527	417	270	266	689	669
投資その他資産	158	149	453	506	1,451	3,766	5,529	8,663	10,987	19,712
資産合計	10,682	12,231	36,591	48,634	58,750	79,010	127,554	140,666	182,146	205,222
負債の部										
流動負債	2,993	3,370	4,979	7,252	12,631	14,171	17,622	18,265	34,804	31,286
支払手形及び買掛金	283	398	1,554	1,614	2,871	4,317	6,466	5,174	8,302	9,890
有利子負債	1,538	1,277	976	1,730	1,728	3,244	4,888	3,502	9,364	7,300
固定負債	4,317	3,335	2,474	5,400	5,754	9,827	8,458	6,973	11,794	20,605
有利子負債	3,662	2,798	1,872	3,373	2,780	6,170	4,480	3,162	2,915	16,140
負債合計	7,310	6,705	7,453	12,652	18,385	23,999	26,081	25,238	46,598	51,891
純資産の部										
純資産	3,371	5,526	29,137	35,981	40,365	55,011	101,473	115,428	135,548	153,331
負債・純資産合計	10,682	12,231	36,591	48,634	58,750	79,010	127,554	140,666	182,146	205,222

セグメント別 業績推移



(百万円)	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
売上高										
ウェーハ再生事業	7,144	9,487	10,973	10,776	11,461	12,717	18,001	20,499	23,794	27,529
プライムウェーハ製造販売事業	－	－	11,918	10,058	8,755	14,780	22,752	18,736	20,443	20,893
半導体関連装置・部材等	1,654	1,393	2,918	4,047	6,272	8,450	11,265	14,057	16,283	30,469
その他、調整額	66	52	△331	△380	△927	△1,327	△2,154	△1,399	△1,320	△2,185
セグメント利益										
ウェーハ再生事業	1,765	3,396	4,011	4,081	4,027	4,731	7,312	8,114	9,059	10,167
プライムウェーハ製造販売事業	－	－	2,048	1,503	1,041	2,539	5,995	3,742	4,743	4,159
半導体関連装置・部材等	230	130	366	171	211	382	914	882	884	1,624
その他、調整額	△409	△543	△675	△1,038	△749	△778	△1,203	△844	△1,578	△1,669
セグメント資産										
ウェーハ再生事業	5,657	8,120	9,150	10,336	11,698	14,302	18,530	21,833	26,163	32,705
プライムウェーハ製造販売事業	－	－	21,313	29,311	35,697	53,202	95,788	100,768	116,144	123,166
半導体関連装置・部材等	1,137	1,305	1,939	3,179	5,387	7,310	6,801	8,775	31,014	30,538
その他、調整額	3,887	2,805	4,315	5,806	5,968	4,243	6,435	9,290	8,823	18,811

- 更なる成長を目指し、継続的な設備投資、研究開発を継続



当該資料に記載された内容は、一般的に認識されている経済情勢及び当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営を取りまく様々な環境の変化により、予告なしに変更される可能性がございます。

本発表において提供される資料ならびに情報の中には「見通し情報」が含まれております。これらの情報は、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実際には異なる結果となる不確実性を含んでおります。

今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。